

TCAL6408 8 ビット変換 I²C バス / SMBus I/O エクスパンダ、割り込み出力、リセット、および Agile I/O 構成レジスタ付き

1 特長

- 1.08V~3.6V の動作電源電圧範囲
- 双方向電圧レベル変換と、1.2V、1.8V、2.5V、3.3V の I²C バスおよび P ポート間での GPIO 拡張が可能
- 低いスタンバイ消費電流: 1 μ A (標準値、1.8V 時)
- 1MHz の高速モード・プラス I²C バス
- ハードウェア・アドレス・ピンにより、同じ I²C/SMBus バス上に 2 つのデバイスを接続可能
- アクティブ Low のリセット入力 (RESET)
- オープン・ドレインのアクティブ Low 割り込み出力 (INT)
- 入力 / 出力構成レジスタ
- 極性反転レジスタ
- 構成可能な I/O 駆動強度レジスタ
- プルアップおよびプルダウン抵抗構成レジスタ
- パワーオン・リセット内蔵
- SCL または SDA 入力のノイズ・フィルタ
- 大電流の最大駆動能力を持つラッチ付き出力により LED を直接駆動
- JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
- JESD 22 を上回る ESD 保護
 - 4000V、人体モデル (A114-A)
 - 1000V、デバイス帯電モデル (C101)

2 アプリケーション

- サーバー
- ルーター (テレコム・スイッチング機器)
- パーソナル・コンピュータ
- パーソナル・エレクトロニクス
- 産業用オートメーション

- ゲーム機
- GPIO が制限されたプロセッサを使用する製品

3 概要

TCAL6408 デバイスは、2 線式双方向 I²C バス (または SMBus) プロトコルに対応する汎用パラレル入出力 (I/O) 拡張機能を提供します。このデバイスは、I²C バス側 (V_{CCI}) で 1.08V~3.6V、P ポート側 (V_{CCP}) で 1.08V~3.6V の電源電圧で動作できます。

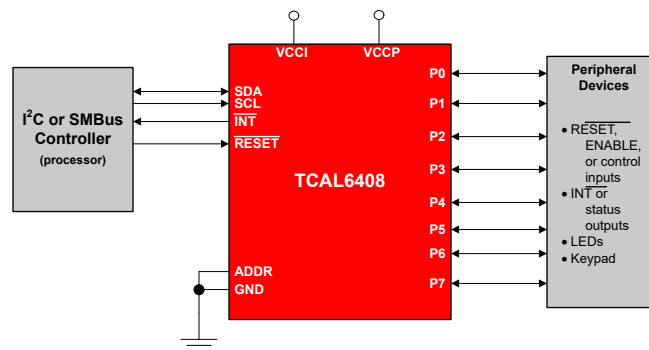
このデバイスは、100kHz (スタンダード・モード)、400kHz (ファスト・モード)、1MHz (ファスト・モード・プラス) の I²C クロック周波数をサポートしています。TCAL6408 をはじめとする I/O エクスパンダは、スイッチ、センサ、押しボタン、LED、ファンなどに I/O を追加する必要がある場合の簡単なソリューションとなります。

TCAL6408 には、速度、消費電力、EMI に関して I/O 性能を向上させる追加機能を備えた Agile I/O ポートが付いています。追加機能として、プログラム可能な出力駆動強度、プログラム可能なプルアップおよびプルダウン抵抗、ラッチ可能な入力、マスク可能な割り込み、割り込みステータス・レジスタ、プログラム可能なオープン・ドレインまたはプッシュプル出力があります。

パッケージ情報

部品番号	パッケージ ⁽¹⁾	パッケージ サイズ ⁽²⁾
TCAL6408	TSSOP (16)	6.4mm × 6.40mm
	UQFN (16)	2.6mm × 1.8mm
	X2QFN (16)	1.6mm × 1.6mm

- (1) 詳細については、[セクション 11](#) を参照してください。
- (2) パッケージ・サイズ (長さ × 幅) は公称値であり、該当する場合はピンも含まれます。



概略回路図



目次

1 特長	1	7.3 機能説明.....	21
2 アプリケーション	1	7.4 デバイスの機能モード.....	23
3 概要	1	7.5 プログラミング.....	23
4 ピン構成および機能	3	7.6 レジスタ・マップ.....	25
5 仕様	5	8 アプリケーションと実装	31
5.1 絶対最大定格.....	5	8.1 アプリケーション情報.....	31
5.2 ESD 定格.....	5	8.2 代表的なアプリケーション.....	31
5.3 推奨動作条件.....	6	8.3 電源に関する推奨事項.....	34
5.4 熱に関する情報.....	6	8.4 レイアウト.....	37
5.5 電気的特性.....	7	9 デバイスおよびドキュメントのサポート	38
5.6 タイミング要件.....	8	9.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法.....	38
5.7 I ² C バス・タイミング要件.....	9	9.2 サポート・リソース.....	38
5.8 スイッチング特性.....	10	9.3 商標.....	38
5.9 代表的な特性.....	11	9.4 静電気放電に関する注意事項.....	38
6 パラメータ測定情報	15	9.5 用語集.....	38
7 詳細説明	19	10 改訂履歴	38
7.1 概要.....	19	11 メカニカル、パッケージ、および注文情報	38
7.2 機能ブロック図.....	20		

4 ピン構成および機能

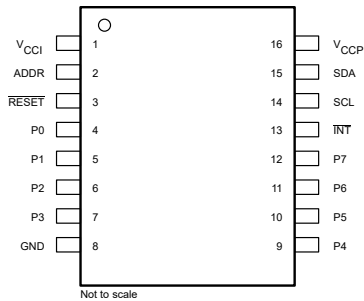


図 4-1. PW (TSSOP) パッケージ、16 ピン
(上面図)

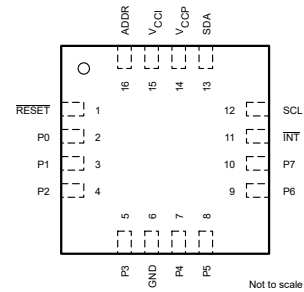


図 4-2. RSV (UQFN) パッケージ、16 ピン
(上面図)

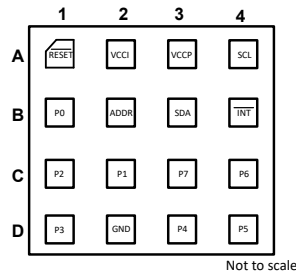


図 4-3. DTU (X2QFN) パッケージ、16 ピン
(上面図)

表 4-1. ピン機能

名称	ピン			タイプ ⁽¹⁾	説明
	PW (TSSOP)	RSV (UQFN)	DTU (X2QFN)		
ADDR	2	16	B2	I	アドレス入力。V _{CCP} またはグランドに直接接続します
GND	8	6	D2	-	GND
INT	13	11	B4	O	割り込み出力。プルアップ抵抗を介して V _{CCI} または V _{CCP} に接続します
P0	4	2	B1	I/O	P ポート入力 / 出力 (プッシュプル設計構造)。電源オン時に、P0 は入力として構成されます
P1	5	3	C2	I/O	P ポート入力 / 出力 (プッシュプル設計構造)。電源オン時に、P1 は入力として構成されます
P2	6	4	C1	I/O	P ポート入力 / 出力 (プッシュプル設計構造)。電源オン時に、P2 は入力として構成されます
P3	7	5	D1	I/O	P ポート入力 / 出力 (プッシュプル設計構造)。電源投入時に、P3 は入力として構成されます
P4	9	7	D3	I/O	P ポート入力 / 出力 (プッシュプル設計構造)。電源オン時に、P4 は入力として構成されます
P5	10	8	D4	I/O	P ポート入力 / 出力 (プッシュプル設計構造)。電源オン時に、P5 は入力として構成されます
P6	11	9	C4	I/O	P ポート入力 / 出力 (プッシュプル設計構造)。電源オン時に、P6 は入力として構成されます
P7	12	10	C3	I/O	P ポート入力 / 出力 (プッシュプル設計構造)。電源オン時に、P7 は入力として構成されます
RESET	3	1	A1	I	アクティブ Low のリセット入力。アクティブな接続が使用されていない場合は、プルアップ抵抗を経由して V _{CCI} に接続します
SCL	14	12	A4	I	シリアル・クロック・バス。プルアップ抵抗を経由して V _{CCI} に接続します
SDA	15	13	B3	I/O	シリアル・データ・バス。プルアップ抵抗を経由して V _{CCI} に接続します
V _{CCI}	1	15	A2	-	I ² C バスの電源電圧。外部 I ² C コントローラの電源電圧に直接接続します

表 4-1. ピン機能 (続き)

ピン				タイプ ⁽¹⁾	説明
名称	PW (TSSOP)	RSV (UQFN)	DTU (X2QFN)		
V _{CCP}	16	14	A3	-	P ボートの TCAL6408 の電源電圧

(1) I=入力、O=出力、I/O=入力または出力、P=電源。

5 仕様

5.1 絶対最大定格

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)⁽¹⁾

			最小値	最大値	単位
V_{CCI} 、 V_{CCP}	電源電圧		-0.5	4	V
V_I	入力電圧 ⁽²⁾		-0.5	4	V
V_O	出力電圧 ⁽²⁾		-0.5	4	V
I_{IK}	入力クランプ電流			-20	mA
I_{OK}	出力クランプ電流			-20	mA
I_{IOK}	入力 / 出力クランプ電流	P ポート	$V_O < 0$ または $V_O > V_{CCP}$	± 20	mA
		SDA	$V_O < 0$ または $V_O > V_{CCI}$	± 20	
I_{OL}	連続出力 Low 電流	P ポート	$V_O = 0 \sim V_{CCP}$	50	mA
		SDA	$V_O = 0 \sim V_{CCI}$	25	
I_{OH}	連続出力 High 電流	P ポート	$V_O = 0 \sim V_{CCP}$	-50	mA
I_{CC}	GND を流れる連続電流			-200	mA
I_{CC}	V_{CCP} を流れる連続電流			160	mA
	V_{CCI} を流れる連続電流			10	
T_J	接合部温度			130	°C
T_{stg}	保存温度		-65	150	°C

- (1) 絶対最大定格の範囲外の動作は、デバイスの永続的な損傷の原因となる可能性があります。絶対最大定格は、このような条件や、「推奨動作条件」に記載されている条件を超える条件でデバイスが機能するということ并不意味着ではありません。推奨動作条件の範囲外で絶対最大定格の範囲内で使用すると、デバイスが完全に機能しなくなる可能性があり、デバイスの信頼性、機能、性能に影響を及ぼし、デバイスの寿命を縮める可能性があります。
- (2) 入力および出力電流定格が観測された場合、入力の負電圧および出力電圧定格を超えることがあります。

5.2 ESD 定格

			値	単位
$V_{(ESD)}$	静電気放電	人体モデル (HBM)、ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 に準拠、すべてのピン ⁽¹⁾	± 4000	V
		デバイス帯電モデル (CDM)、ANSI/ESDA/JEDEC 仕様 JS-002 に準拠、すべてのピン ⁽²⁾	± 1000	

- (1) JEDEC のドキュメント JEP155 には、500V HBM であれば標準的な ESD 管理プロセスで安全な製造が可能であると記載されています。
- (2) JEDEC のドキュメント JEP157 には、250V CDM であれば標準的な ESD 管理プロセスで安全な製造が可能であると記載されています。

5.3 推奨動作条件

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)

			最小値	最大値	単位
V_{CC1} 、 V_{CCP}	電源電圧		1.08	3.6	V
V_{IH}	High レベル入力電圧	SCL、SDA、 $\overline{\text{RESET}}$	$0.7 * V_{CC1}$	3.6	V
		P0~P7、ADDR	$0.7 * V_{CCP}$	3.6	
V_{IL}	Low レベル入力電圧	SCL、SDA、 $\overline{\text{RESET}}$	-0.5	$0.3 * V_{CC1}$	V
		P0~P7、ADDR	-0.5	$0.3 * V_{CCP}$	V
I_{OH}	High レベル出力電流	P0~P7		-10	mA
I_{OL}	Low レベル出力電流	P0~P7		25	mA
T_A	周囲温度		-40	125	°C
T_J	接合部温度			125	°C

5.4 熱に関する情報

熱評価基準 ⁽¹⁾		パッケージ			単位
		PW (TSSOP)	RSV (UQFN)	DTU (X2QFN)	
		ピン数	ピン数	ピン数	
$R_{\theta JA}$	接合部から周囲への熱抵抗	115.7	123.1	143.4	°C/W
$R_{\theta JC(top)}$	接合部からケース (上面) への熱抵抗	46.1	65.0	55.6	°C/W
$R_{\theta JB}$	接合部から基板への熱抵抗	62.0	54.6	81.9	°C/W
Ψ_{JT}	接合部から上面への特性パラメータ	6.0	2.9	1.3	°C/W
Ψ_{JB}	接合部から基板への特性パラメータ	61.4	52.9	81.8	°C/W

(1) 従来および最新の熱評価基準の詳細については、『[半導体および IC パッケージの熱評価基準](#)』アプリケーション・レポートを参照してください。

5.5 電気的特性

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)

パラメータ		テスト条件	V _{CCP}	最小値	標準値	最大値	単位
V _{IK}	入力ダイオード・クランプ電圧	I _I = -18mA	1.08V~3.6V	-1.2			V
V _{PORR}	パワーオン・リセット電圧、V _{CC} 立ち上がり	V _I = V _{CC} または GND、I _O = 0			0.85	1.0	V
V _{PORF}	パワーオン・リセット電圧、V _{CC} 立ち下がり	V _I = V _{CC} または GND、I _O = 0		0.6	0.75		V
V _{IH}	High レベル入力電圧	SDA、SCL	1.08~3.6V	0.7 x V _{CC}			V
		P ポート、ADDR、A1、A2、RESET	1.08~3.6V	0.7 x V _{CC}			V
V _{IL}	Low レベル入力電圧	SDA、SCL	1.08~3.6V			0.4 x V _{CC}	V
		P ポート、ADDR、A1、A2、RESET	1.08~3.6V			0.3 x V _{CC}	V
V _{OH}	P ポート High レベル出力電圧 ⁽¹⁾	I _{OH} = -8mA、CCX.X = 11b	1.08V	0.8			V
			1.65V	1.4			
			2.3V	2.1			
			3V	2.8			
		I _{OH} = -2.5mA および CCX.X = 00b、 I _{OH} = -5mA および CCX.X = 01b、 I _{OH} = -7.5mA および CCX.X = 10b、 I _{OH} = -10mA & CCX.X = 11b	1.08V	0.75			
			1.65V	1.4			
			2.3V	2.1			
			3V	2.8			
V _{OL}	Low レベル出力電圧	P ポート	I _{OL} = 8mA、CCX.X = 11b	1.08V		0.2	V
				1.65V		0.15	
				2.3V		0.1	
				3.0V		0.1	
		P ポート	I _{OL} = 2.5mA および CCX.X = 00b、 I _{OL} = 5mA および CCX.X = 01b、 I _{OL} = 7.5mA および CCX.X = 10b、 I _{OL} = 10mA および CCX.X = 11b	1.08V		0.25	V
				1.65V		0.15	
				2.3V		0.1	
				3.0V		0.1	
I _{OL}	Low レベル出力電流	SDA	V _{OL} = 0.4V	1.08V~3.6V	20		mA
		INT	V _{OL} = 0.4V		4		
I _I	入力リーク電流	P ポート	V _I = V _{CC} または GND	1.08V~3.6V		±1	μA
			V _I = 3.6V	0V		±1	
I _I	入力リーク電流	SCL、SDA、RESETZ	V _I = V _{CC} または GND	1.08V~3.6V		±1	μA
I _I	入力リーク電流	ADDR	V _I = V _{CC} または GND	1.08V~3.6V		±1	μA

5.5 電気的特性 (続き)

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)

パラメータ		テスト条件	V _{CCP}	最小値	標準値	最大値	単位
I _{CC} (I _{CCI} + I _{CCP})	静止時電流	動作モード (400kHz)	SDA, $\overline{\text{RESET}} = V_{\text{CCI}}$, P ポート, ADDR = V _{CCP} または GND, I/O = 入力, f _{SCL} = 400kHz, -40°C < T _A ≤ 85°C, IO 抵抗はディセー ープル	3.6V		7 15	μA
			2.7V		5 11		
			1.95V		4 8		
			1.32V		2 6		
			3.6V		7 24		
			2.7V		5 18		
		1.95V		4 14			
		1.32V		2 11			
		動作モード (1MHz)	SDA, $\overline{\text{RESET}} = V_{\text{CCI}}$, P ポート, ADDR = V _{CCP} または GND, I/O = 入力, f _{SCL} = 400kHz, 85°C < T _A ≤ 125°C, IO 抵抗はディセー ープル	3.6V		34	μA
			2.7V		24		
			1.95V		18		
			1.32V		12		
3.6V			42				
2.7V			30				
1.95V		22					
1.32V		16					
スタンバイ・モード	SCL, SDA, $\overline{\text{RESET}} = V_{\text{CCI}}$, P ポート, ADDR = V _{CCP} または GND, I/O = 入力, I _O = 0, f _{SCL} = 0kHz, -40°C < T _A ≤ 85°C, IO 抵抗はディセー ープル	3.6V	1.5	3	μA		
	2.7V	1.2	2.0				
	1.95V	0.6	1.6				
	1.32V	0.6	1.4				
	3.6V		14				
	2.7V		10				
1.95V		8					
1.32V		6					
R _{pu(int)}	内部プルアップ抵抗	P ポート		70	100	140	kΩ
R _{pd(int)}	内部プルダウン抵抗						
C _i	入力ピン容量	SCL	V _I = V _{CC} または GND	1.08V~3.6V	2.5	5	pF
C _{IO}	入力 / 出力ピンの容量	SDA	V _{IO} = V _{CC} または GND	1.08V~3.6V	6	8	pF
		P ポート	V _{IO} = V _{CC} または GND	1.08V~3.6V	6	8.5	

(1) 各 I/O は、外部で最大 25mA に制限する必要があります

5.6 タイミング要件

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)

		最小値	最大値	単位
RESET				
t _w	リセット・パルス時間	80		ns
t _{REC}	リセット復帰時間	0		ns
t _{RESET}	リセットまでの時間	400		ns

5.6 タイミング要件 (続き)

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)

		最小値	最大値	単位
P ポート				
t_{PH}	割り込みを発生させる P ポートの最小パルス幅	30		ns

5.7 I²C バス・タイミング要件

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)

		最小値	最大値	単位	
I²C バス - 標準モード					
f_{SCL}	I ² C クロック周波数	0	100	kHz	
t_{SCH}	I ² C クロックの High 時間	4		μs	
t_{SCL}	I ² C クロックの Low 時間	4.7		μs	
t_{SP}	I ² C スパイク時間		50	ns	
t_{SDS}	I ² C シリアル・データ・セットアップ時間	250		ns	
t_{SDH}	I ² C シリアル・データ・ホールド時間	0		ns	
t_{ICR}	I ² C 入力の立ち上がり時間		1000	ns	
t_{ICF}	I ² C 入力の立ち下がり時間		300	ns	
t_{OCF}	I ² C 出力の立ち下がり時間	10pF~400pF バス	300	ns	
t_{BUF}	STOP と START 間の I ² C バスのフリー時間	4.7		μs	
t_{STS}	I ² C START または反復 START 条件の設定	4.7		μs	
t_{STH}	I ² C START または反復 START 条件ホールド	4		μs	
t_{SPS}	I ² C STOP 条件の設定	4		μs	
$t_{VD}(data)$	有効データ時間	SCL Low から SDA 出力有効まで	3.45	μs	
$t_{VD}(ack)$	ACK 条件の有効データ時間	SCL Low から SDA (出力) Low への ACK 信号	3.45	μs	
C_b	I ² C バスの容量性負荷		400	pF	
I²C バス - 高速モード					
f_{SCL}	I ² C クロック周波数	0	400	kHz	
t_{SCH}	I ² C クロックの High 時間	0.6		μs	
t_{SCL}	I ² C クロックの Low 時間	1.3		μs	
t_{SP}	I ² C スパイク時間		50	ns	
t_{SDS}	I ² C シリアル・データ・セットアップ時間	100		ns	
t_{SDH}	I ² C シリアル・データ・ホールド時間	0		ns	
t_{ICR}	I ² C 入力の立ち上がり時間	20	300	ns	
t_{ICF}	I ² C 入力の立ち下がり時間	20 x (V _{CC} /5.5V)	300	ns	
t_{OCF}	I ² C 出力の立ち下がり時間	10pF~400pF バス	20 x (V _{CC} /5.5V)	300	ns
t_{BUF}	STOP と START 間の I ² C バスのフリー時間	1.3		μs	
t_{STS}	I ² C START または反復 START 条件の設定	0.6		μs	
t_{STH}	I ² C START または反復 START 条件ホールド	0.6		μs	
t_{SPS}	I ² C STOP 条件の設定	0.6		μs	
$t_{VD}(data)$	有効データ時間	SCL Low から SDA 出力有効まで	0.9	μs	

5.7 I²C バス・タイミング要件 (続き)

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)

			最小値	最大値	単位
t _{vd(ack)}	ACK 条件の有効データ時間	SCL Low から SDA (出力) Low への ACK 信号		0.9	μs
C _b	I ² C バスの容量性負荷			400	pF
I²C バス - 高速モード・プラス					
f _{scl}	I ² C クロック周波数		0	1000	kHz
t _{sch}	I ² C クロックの High 時間		0.26		μs
t _{scl}	I ² C クロックの Low 時間		0.5		μs
t _{sp}	I ² C スパイク時間			50	ns
t _{sds}	I ² C シリアル・データ・セットアップ時間		50		ns
t _{sdh}	I ² C シリアル・データ・ホールド時間		0		ns
t _{icr}	I ² C 入力の立ち上がり時間			120	ns
t _{icf}	I ² C 入力の立ち下がり時間		20 x (V _{CC} /5.5V)	120	ns
t _{ocf}	I ² C 出力の立ち下がり時間	10pF~550pF バス	20 x (V _{CC} /5.5V)	120	ns
t _{buf}	STOP と START 間の I ² C バスのフリー時間		0.5		μs
t _{sts}	I ² C START または反復 START 条件の設定		0.26		μs
t _{sth}	I ² C START または反復 START 条件ホールド		0.26		μs
t _{sps}	I ² C STOP 条件の設定		0.26		μs
t _{vd(data)}	有効データ時間	SCL Low から SDA 出力有効まで		0.45	μs
t _{vd(ack)}	ACK 条件の有効データ時間	SCL Low から SDA (出力) Low への ACK 信号		0.45	μs
C _b	I ² C バスの容量性負荷			550	pF

5.8 スイッチング特性

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)

パラメータ		始点 (入力)	終点 (出力)	最小値	標準値	最大値	単位
t _{iv}	割り込み有効時間 (R _{PU} = 4.7kΩ、C _L = 100pF)	P ポート	INT			1	μs
t _{ir}	割り込みリセット遅延時間 (R _{PU} = 4.7kΩ、C _L = 100pF)	SCL	INT			1	μs
t _{pv}	出力データ有効時間	SCL	P ポート			400	ns
t _{ps}	入力データ・セットアップ時間	P ポート	SCL	0			ns
t _{ph}	入力データ・ホールド時間	P ポート	SCL	300			ns
t _{skew_fall}	SCL から SDA へのスキュー時間 (シミュレーションのみ) - 立ち下がりエッジ	SCL	SDA	5		80	ns
t _{skew_rise}	SCL から SDA へのスキュー時間 (シミュレーションのみ) - 立ち上がりエッジ	SCL	SDA	-20		80	ns

5.9 代表的な特性

$T_A = 25^\circ\text{C}$ (特に記述のない限り)

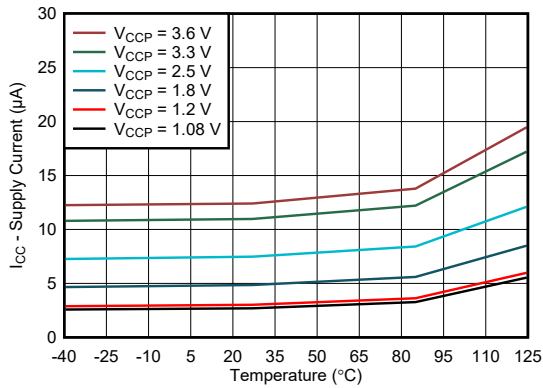


図 5-1. 消費電流と温度との関係 - FM モード

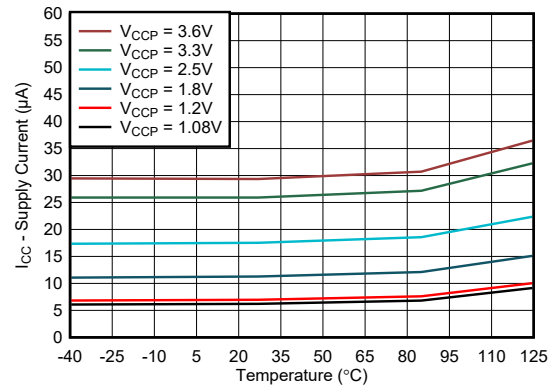


図 5-2. 消費電流と温度との関係 - FM+ モード

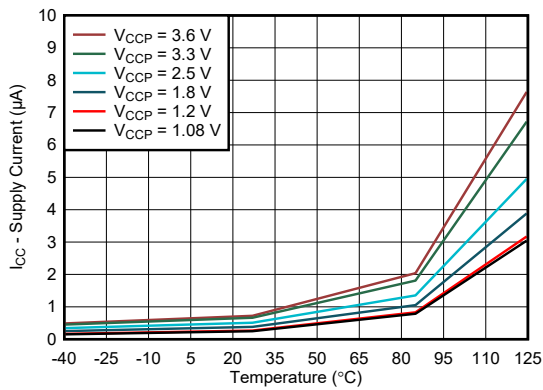


図 5-3. スタンバイ消費電流と温度との関係

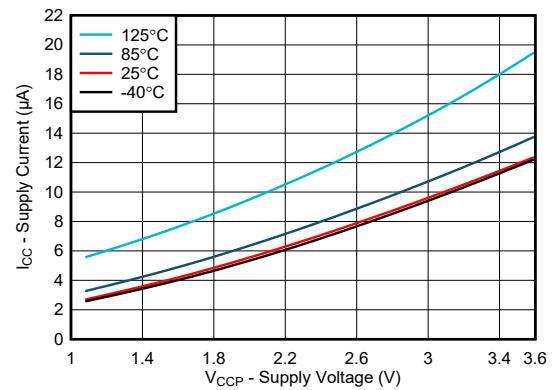


図 5-4. 消費電流と電源電圧との関係 - FM モード

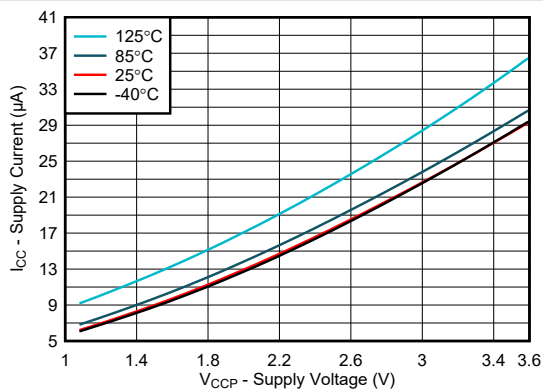


図 5-5. 消費電流と電源電圧との関係 - FM+ モード

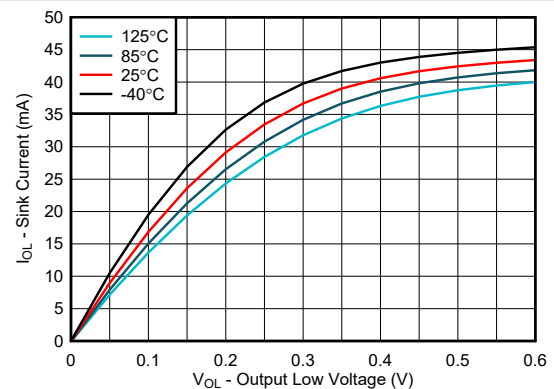


図 5-6. I/O シンク電流と出力低電圧との関係、 $V_{CCP} = 1.08\text{V}$

5.9 代表的な特性 (続き)

$T_A = 25^\circ\text{C}$ (特に記述のない限り)

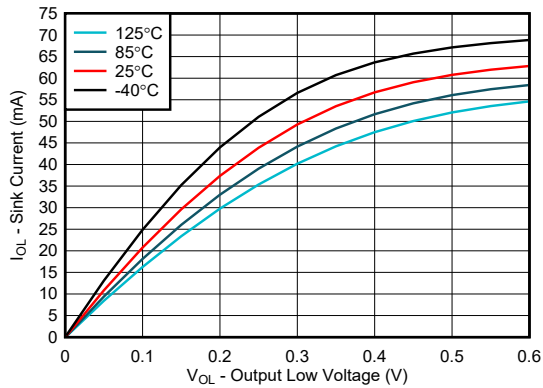


図 5-7. I/O シンク電流と出力低電圧との関係、 $V_{CCP} = 1.2\text{V}$

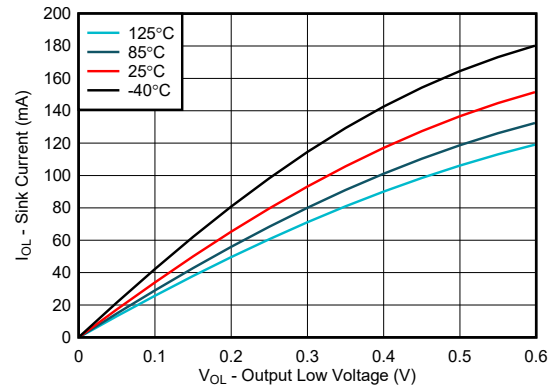


図 5-8. I/O シンク電流と出力低電圧との関係、 $V_{CCP} = 1.8\text{V}$

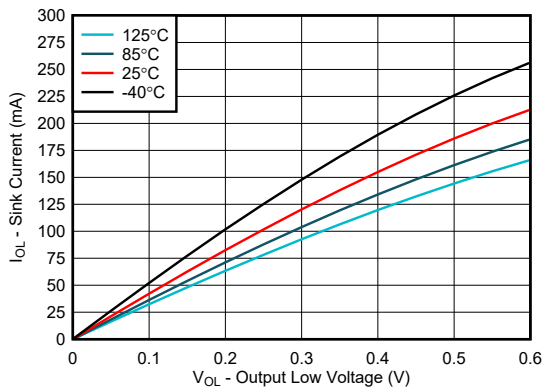


図 5-9. I/O シンク電流と出力低電圧との関係、 $V_{CCP} = 2.5\text{V}$

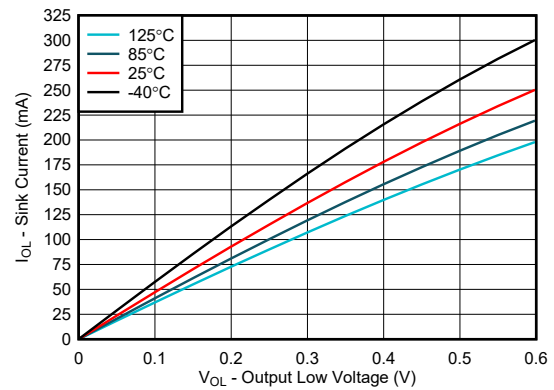


図 5-10. I/O シンク電流と出力低電圧との関係、 $V_{CCP} = 3.3\text{V}$

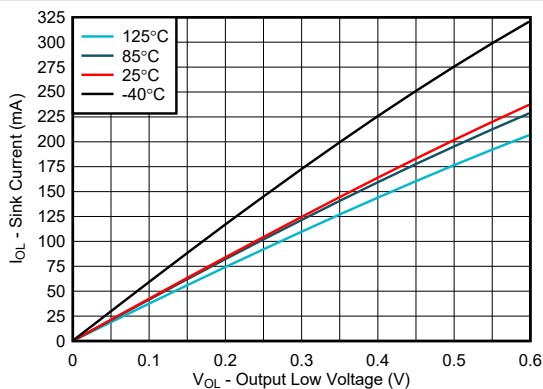


図 5-11. I/O シンク電流と出力低電圧との関係、 $V_{CCP} = 3.6\text{V}$

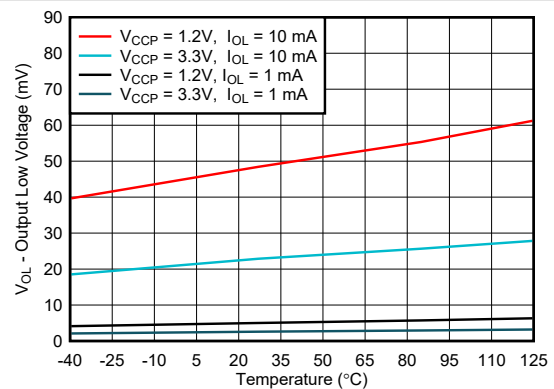


図 5-12. I/O 低電圧と温度との関係

5.9 代表的な特性 (続き)

$T_A = 25^\circ\text{C}$ (特に記述のない限り)

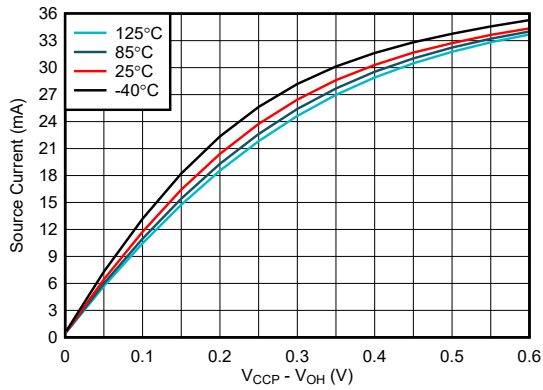


図 5-13. I/O ソース電流と出力高電圧との関係、
 $V_{CCP} = 1.08\text{V}$

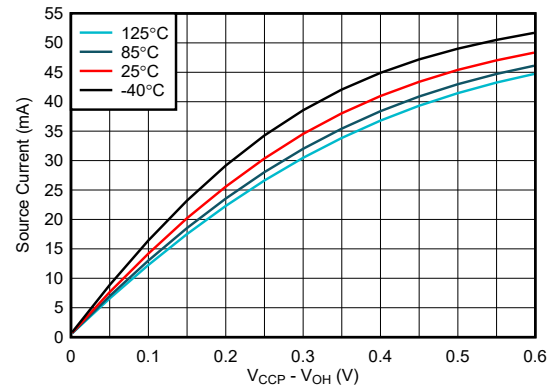


図 5-14. I/O ソース電流と出力高電圧との関係、
 $V_{CCP} = 1.2\text{V}$

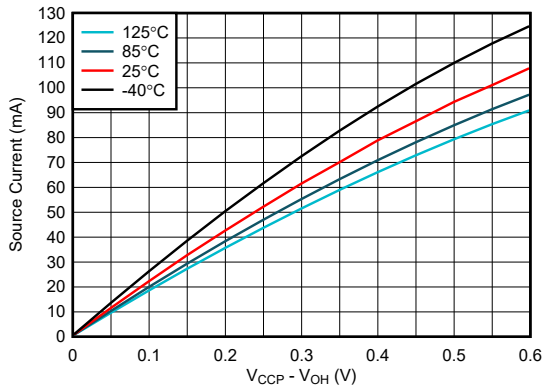


図 5-15. I/O ソース電流と出力高電圧との関係、
 $V_{CCP} = 1.8\text{V}$

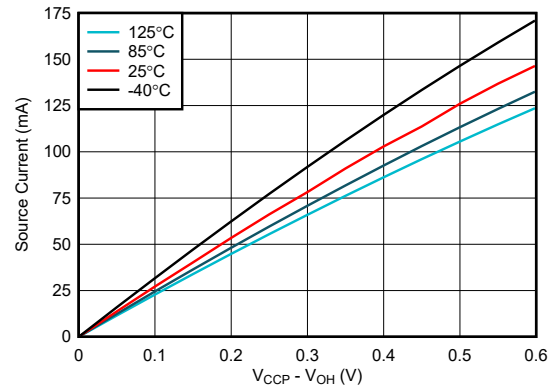


図 5-16. I/O ソース電流と出力高電圧との関係、
 $V_{CCP} = 2.5\text{V}$

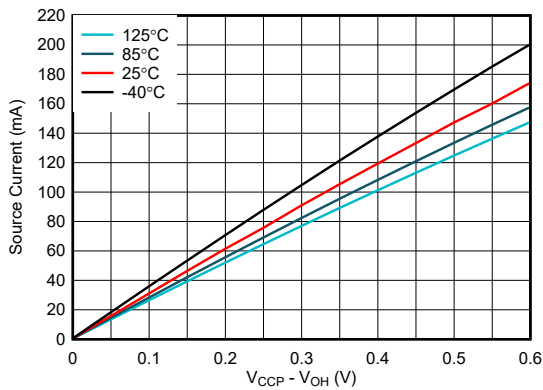


図 5-17. I/O ソース電流と出力高電圧との関係、
 $V_{CCP} = 3.3\text{V}$

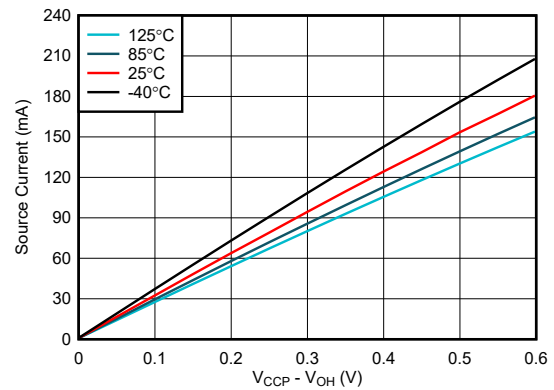


図 5-18. I/O ソース電流と出力高電圧との関係、
 $V_{CCP} = 3.6\text{V}$

5.9 代表的な特性 (続き)

$T_A = 25^\circ\text{C}$ (特に記述のない限り)

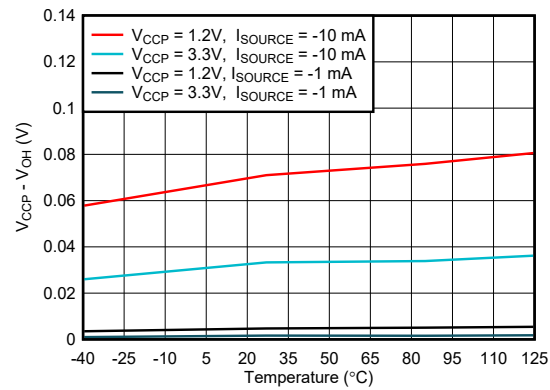
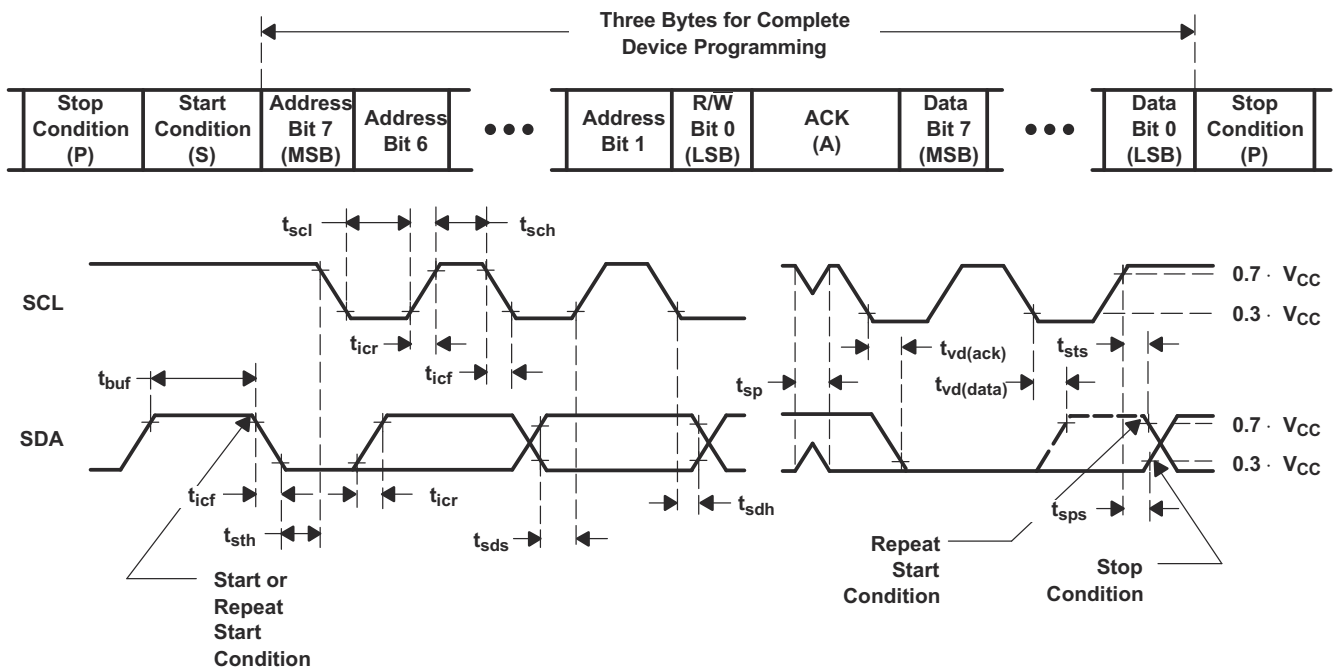
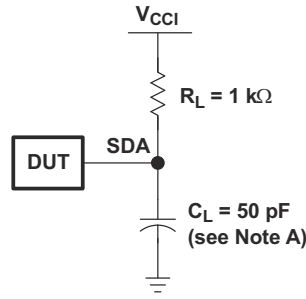


図 5-19. I/O 高電圧と温度との関係

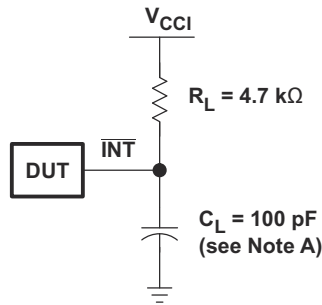
6 パラメータ測定情報



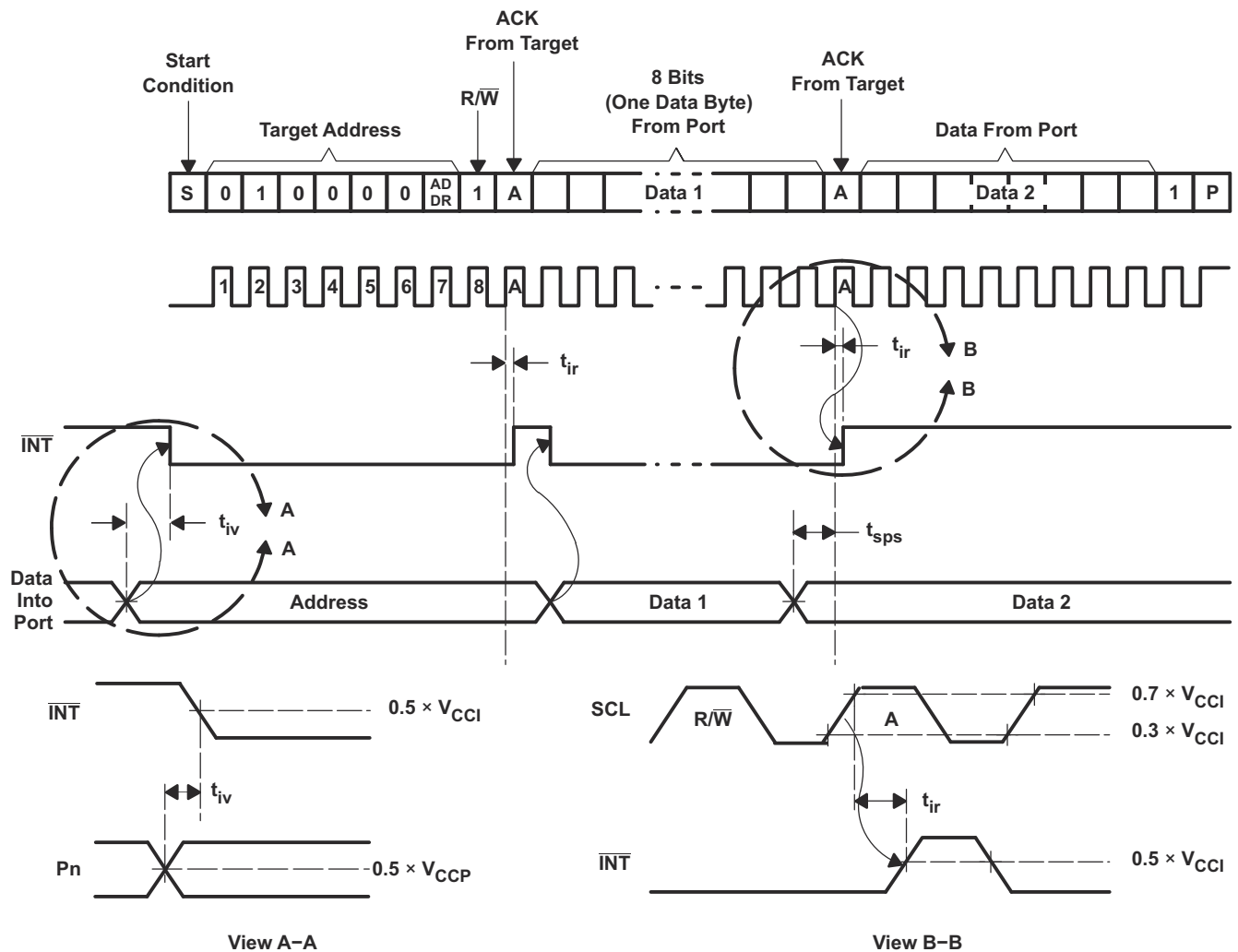
BYTE	DESCRIPTION
1	I ² C address
2, 3	P-port data

- A. C_L には、プローブと治具の容量が含まれます。toct は、10pF または 400pF の C_L で測定されます。
- B. すべての入力、以下の特性を持つジェネレータから供給されます: PRR ≤ 10MHz、 $Z_O = 50\Omega$ 、 $t_r/t_f \leq 30ns$ 。
- C. すべてのパラメータと波形が、すべてのデバイスに適用できるわけではありません。

図 6-1. I²C インターフェイスの負荷回路と電圧波形

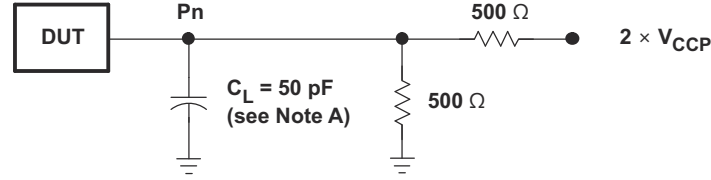


INTERRUPT LOAD CONFIGURATION

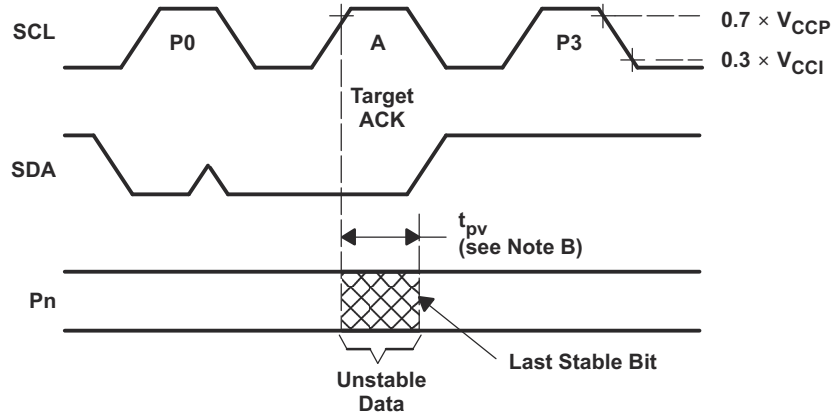


- A. C_L にはプローブと治具の容量が含まれます。
- B. すべての入力、以下の特性を持つジェネレータから供給されます: $PRR \leq 10\text{MHz}$, $Z_0 = 50\Omega$, $t_r/t_f \leq 30\text{ns}$ 。
- C. すべてのパラメータと波形が、すべてのデバイスに適用できるわけではありません。

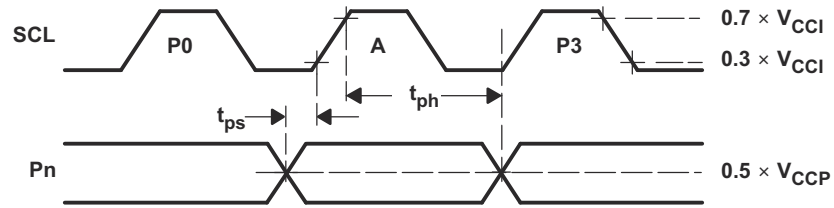
図 6-2. 割り込み負荷回路および電圧波形



P-PORT LOAD CONFIGURATION



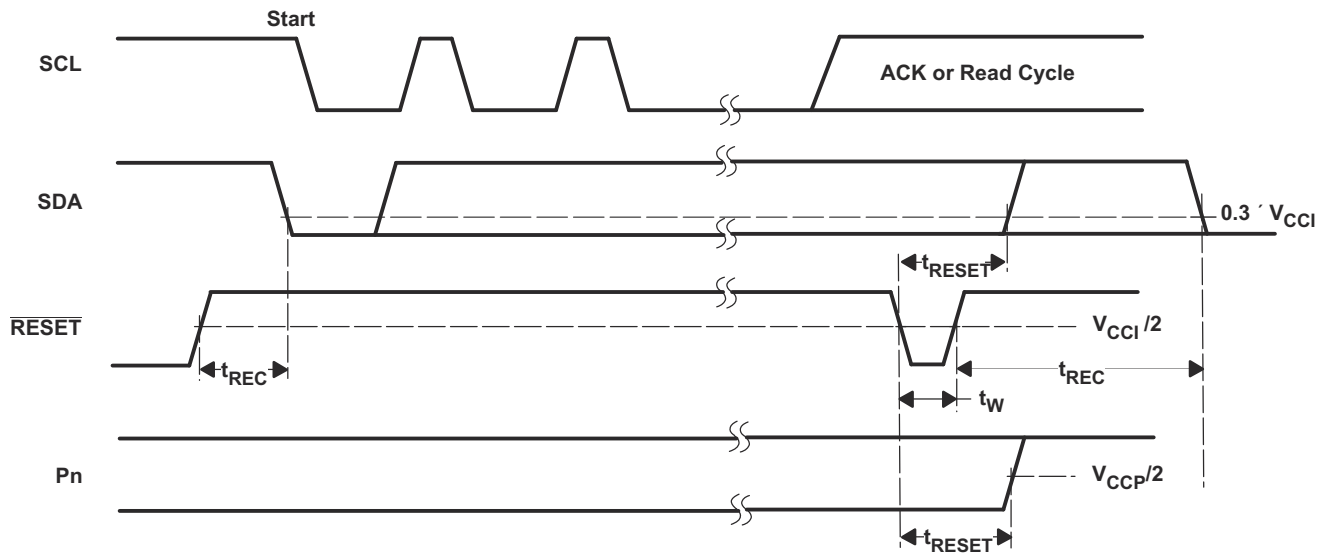
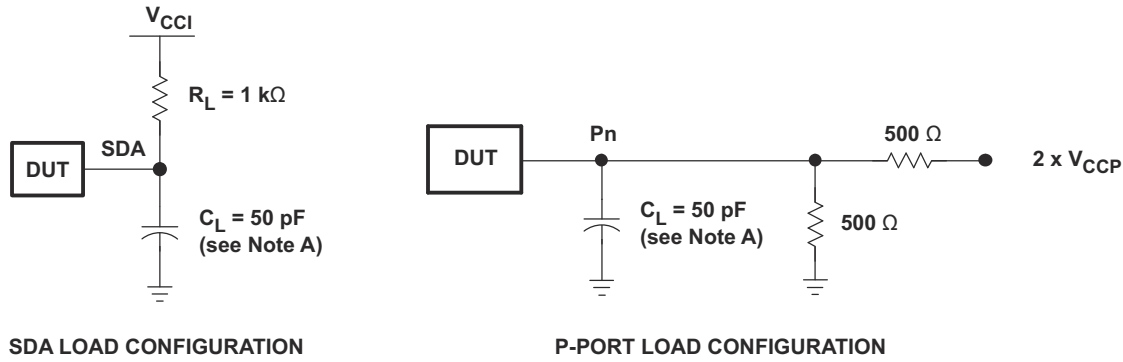
WRITE MODE ($R/\bar{W} = 0$)



READ MODE ($R/\bar{W} = 1$)

- A. C_L にはプローブと治具の容量が含まれます。
- B. t_{pv} は、SCL で $0.7 \times V_{CC}$ から 50% の I/O (On) 出力まで測定されます。
- C. すべての入力は、以下の特性を持つジェネレータから供給されます: $PRR \leq 10\text{MHz}$, $Z_O = 50\Omega$, $t_r/t_f \leq 30\text{ns}$.
- D. 出力は一度に 1 つずつ測定され、測定するたびに 1 回遷移します。
- E. すべてのパラメータと波形が、すべてのデバイスに適用できるわけではありません。

図 6-3. P ポートの負荷回路およびタイミング波形



- A. C_L にはプローブと治具の容量が含まれます。
- B. すべての入力、以下の特性を持つジェネレータから供給されます: $PRR \leq 10\text{MHz}$ 、 $Z_O = 50\Omega$ 、 $t_r/t_f \leq 30\text{ns}$ 。
- C. 出力は一度に 1 つずつ測定され、測定するたびに 1 回遷移します。
- D. I/O は入力として構成されます。
- E. すべてのパラメータと波形が、すべてのデバイスに適用できるわけではありません。

図 6-4. リセット負荷回路および電圧波形

7 詳細説明

7.1 概要

TCAL6408 は、幅広い範囲の電源電圧の電圧変換に対応しています。そのため、デバイスは I²C 側で最新のプロセッサとのインターフェイスが可能となり、電源レベルが低くなるため、消費電力の節約になります。プロセッサの電源供給は低下しますが、LED など PCB の部品には依然としてより高い電圧供給が必要です。

V_{CCI} ピンは I²C バスの電源供給となるため、SCL、SDA、RESET ピンに接続されたプルアップ抵抗は V_{CCI} で終端する必要があります。INT 出力にはオープン・ドレイン構造があり、アプリケーションに応じて、V_{CCP} または V_{CCI} への外部プルアップ抵抗が必要です。V_{CCP} ピンは、P ポートへの電源供給となります。いずれかの P ポートで外部プルアップ抵抗を使用するか、または LED をいずれかの P ポートで駆動する場合、P0-P7 に接続される抵抗または LED は V_{CCP} で終端する必要があります。デバイスの P ポートを出力として構成すると、LED を直接駆動するために最大 25mA までシンクできますが、追加の外部抵抗により電流を制限する必要があります。

TCAL6408 のデジタル・コアは 8 ビットのデータ・レジスタで構成されており、ユーザーは I/O ポートの特定を構成することができます。電源オン時、またはリセット後に、I/O は入力として構成されます。ただし、Configuration レジスタに書き込むことにより、システム・コントローラは I/O を入力または出力のどちらにも構成することが可能です。各入力または出力のデータは、対応する Input Port レジスタまたは Output Port レジスタに保持されます。Input Port レジスタの極性は、Polarity Inversion レジスタで反転することができます。すべてのレジスタは、システム・コントローラで読み出すことができます。さらに、TCAL6408 には、I/O ポートの強化に特化した Agile I/O 機能が搭載されています。Agile I/O 機能とレジスタには、プログラム可能な出力駆動強度、プログラム可能なプルアップ抵抗とプルダウン抵抗、ラッチ可能な入力、マスク可能な割り込み、割り込みステータス・レジスタ、プログラム可能なオープン・ドレインまたはプッシュプル出力が含まれています。これらの Configuration レジスタにより柔軟性が向上するため、I/O は強化され、ユーザーは消費電力、スピード、EMI などの設計を最適化できるようになります。

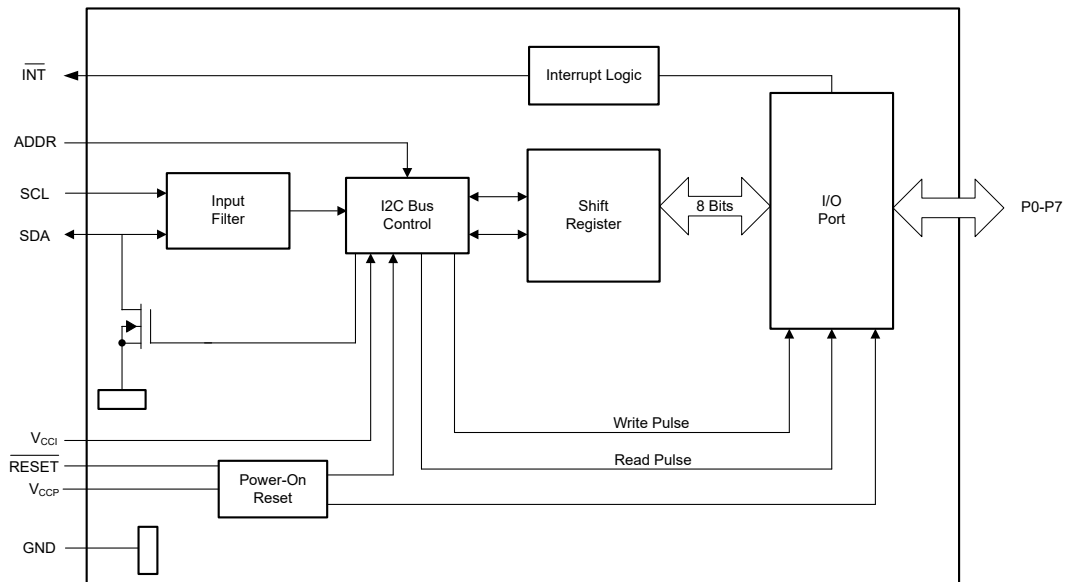
デバイスの他の機能には、入力ポートの状態が変化するたびに INT ピンで発生する割り込みがあります。デバイスをデフォルトの状態にリセットするには、RESET ピンに Low 論理レベルを印加するか、ソフトウェア・リセット・コマンドを送信するか、またはデバイスの電源を一度切ってパワーオン・リセットを行います。ADDR ハードウェア・セレクトラブル・アドレス・ピンを使用することで、2 つの TCAL6408 デバイスを同じ I²C バスに接続することができます。

TCAL6408 のオープン・ドレイン割り込み (INT) 出力は、いずれかの入力状態が対応する Input Port レジスタの状態と異なる場合にアクティブになって、入力状態が変化したことをシステム・コントローラに示すために使用されます。INT ピンは、プロセッサの割り込み入力に接続することができます。このラインで割り込み信号を送信することにより、デバイスは I²C バスで通信しなくても、リモート I/O ポートに受信データがあるかどうかをプロセッサに通知することができます。

システム・コントローラは、タイムアウト時、またはその他の不正な動作時に、RESET 入力ピンに Low をアサートするか、または V_{CCP} ピンへの電源を一度切ってパワーオン・リセット (POR) することにより、リセットすることができます。リセットにより、レジスタはデフォルト状態になり、I²C/SMBus ステート・マシンは初期化されます。RESET 機能でも POR でも、同じようにリセット / 初期化を行えますが、RESET 機能はデバイスの電源をオフにする必要がありません。

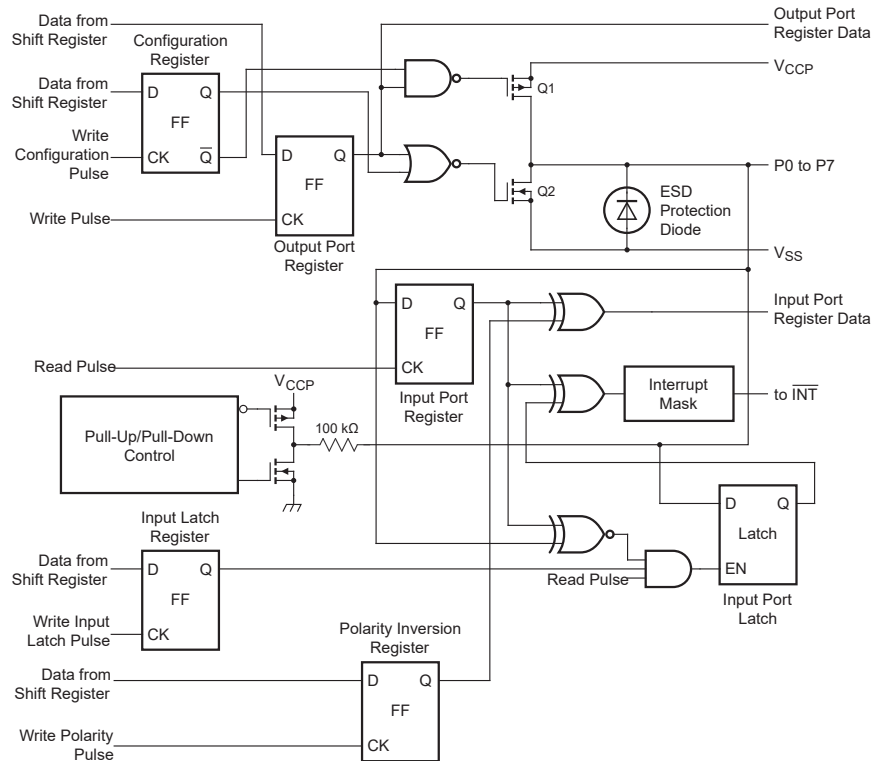
1 本のハードウェア・ピン (ADDR) を使用すると、固定 I²C アドレスをプログラムして変更することができ、2 つのデバイスで同じ I²C バスや SMBus を共有することができます。

7.2 機能ブロック図



A. すべての I/O は、リセット時に入力に設定されます。

図 7-1. 論理図 (正論理)



A. 電源オンまたはリセット時に、すべてのレジスタがデフォルト値に戻ります。

図 7-2. P0 から P7 の概略回路図

7.3 機能説明

7.3.1 電圧レベル変換

表 7-1 に、TCAL6408 でサポートされる I²C バス (V_{CCI}) と P ポート (V_{CCP}) 用のすべての電源電圧レベル・オプションの組み合わせを示します。

表 7-1. 電圧レベル変換

V _{CCI} (I ² C コントローラの SDA および SCL) (V)	V _{CCP} (P ポート) (V)
1.2	1.2
1.2	1.8
1.2	2.5
1.2	3.3
1.8	1.2
1.8	1.8
1.8	2.5
1.8	3.3
2.5	1.2
2.5	1.8
2.5	2.5
2.5	3.3
3.3	1.2
3.3	1.8
3.3	2.5
3.3	3.3

7.3.2 I/O ポート

I/O が入力として構成されている場合、FET Q1 と Q2 はオフになり (図 8-2 を参照)、高インピーダンス入力が生成されず。入力電圧は、電源電圧より高い、最大 3.6V まで上昇させることができます。

I/O が出力として構成されている場合、Q1 または Q2 は出力ポート・レジスタの状態に応じてイネーブルになります。この場合、I/O ピンと電源または GND の間に低インピーダンスのパスがあります。この I/O ピンに印加される外部電圧は、適切に動作させるために推奨レベルを超えないようにする必要があります。

7.3.3 調整可能な出力駆動強度

Output Drive Strength レジスタを使用すると、GPIO の駆動レベルを制御することができます。各 GPIO は、4 種類の電流レベルのいずれか 1 つに個別に構成できます。これらのビットをプログラムすることにより、ユーザーはトランジスタ・ペアの数か I/O パッドを駆動する「フィンガー」数を変更します。図 8-3 に、簡単な出力段を示します。パッドの動作は、Configuration レジスタ、出力ポートのデータ、Current Control レジスタの影響を受けます。Current Control レジスタ・ビットを 01b にプログラムすると、2 つのフィンガーのみアクティブになり、電流駆動能力は 50% 低下します。

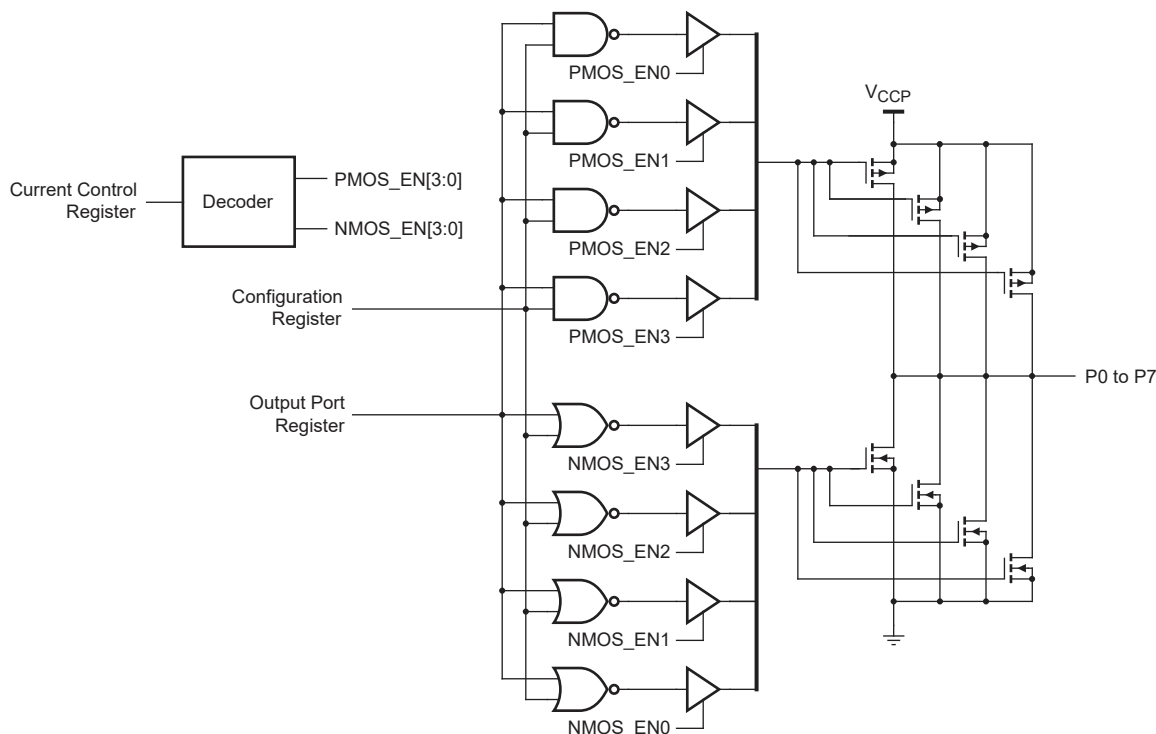


図 7-3. 簡単な出力段

システム・ノイズを低減するために電流駆動能力を低下させることをお勧めします。出力が切り替わると、出力駆動の選択によってピーク電流が発生します。このピーク電流は電源と GND パッケージのインダクタンスを経由して流れ、ノイズ (一部は放射されますが、多くは影響の大きな同時スイッチング・ノイズ (SSN)) を生成します。つまり、同時に多くの出力を切り替えるとグラウンド・ノイズと電源ノイズが発生します。出力駆動強度を Output Drive Strength レジスタで制御することにより、ユーザーは外部の部品を追加することなく、SSN の問題を低減することができます。

7.3.4 割り込み出力 ($\overline{\text{INT}}$)

割り込み機能がマスクされていない場合、入力モードでのポート入力の立ち上がりエッジまたは立ち下がりエッジによって割り込みが生成されます。 t_{IV} 時間が経過すると、 $\overline{\text{INT}}$ 信号は有効になります。割り込み回路は、ポート上のデータが元の設定に戻されたとき、または割り込みを生成したポートからデータが読み取られたときにリセットされます。リセットは、読み取りモード時に SCL 信号の立ち上がりエッジの後のアクノリッジ (ACK) ビットで発生します。ACK クロック・パルス中に発生する割り込みは、このパルス中に割り込みがリセットされるため、失われる (または非常に短くなる) ことがあります。リセット後に I/O の各変化が検出され、 $\overline{\text{INT}}$ として送信されます。

他のデバイスとの間での読み取りや書き込みは、割り込み回路に影響しません。また、出力として構成されたピンが割り込みを発生させることはありません。I/O を出力から入力に変更すると、ピンの状態が入力ポート・レジスタの内容と一致しない場合、誤って割り込みが発生する可能性があります。

$\overline{\text{INT}}$ 出力にはオープン・ドレイン構造があり、アプリケーションに応じて、 V_{CCP} または V_{CCI} への外部プルアップ抵抗が必要です。 $\overline{\text{INT}}$ のプルアップ抵抗は、割り込み情報を必要とするデバイスの電圧源に接続する必要があります。

7.3.5 リセット入力 ($\overline{\text{RESET}}$)

$\overline{\text{RESET}}$ 入力をアサートして、 V_{CCP} 電源を動作レベルに保持しながら、システムを初期化することができます。リセットを行うには、 t_W の最小時間の間、 $\overline{\text{RESET}}$ ピンを Low に保持します。TCAL6408 のレジスタと I²C/SMBus のステート・マシンは、 $\overline{\text{RESET}}$ が Low (0) になると、デフォルト状態に変更されます。 $\overline{\text{RESET}}$ が High (1) になると、P ポートの I/O レベルは外部から、またはコントローラを使用して変更できます。アクティブ接続が使用されない場合、この入力には V_{CCI}

へのプルアップ抵抗が必要です。**RESET** がトグル切り替えされると、Input Port レジスタは GPIO ピンの状態を反映して更新されます。

7.3.6 ソフトウェア・リセット呼び出し

ソフトウェア・リセット呼び出しは、I2C バス上のコントローラから送信されるコマンドで、このコマンドに対応しているすべてのデバイスに対して電源オンのデフォルト状態にリセットするよう指示を出します。想定どおりに機能させるためには、I2C バスの機能を有効にして、このバスにデバイスが接続されていない状態にする必要があります。

ソフトウェア・リセット呼び出しは、以下の手順で定義します：

1. I2C バスのコントローラから **START** 条件を送信します。
2. 使用するアドレスは、予約済みのジェネラル・コールの I2C バス・アドレスで、R/W ビットを **0** にセットした「**0000 0000**」です。送信されるバイトは、**0x00** です。
3. ジェネラル・コール機能をサポートしているすべてのデバイスは、**ACK** を送信します。R/W ビットが **1** (読み出し) にセットされると、デバイスは **NACK** を送信します。
4. ジェネラル・コール・アドレスの送信が確認されると、コントローラは **0x06** に相当するデータの **1** バイトのみを送信します。データ・バイトが他の値の場合、デバイスは応答を送信しないか、またはリセットを行います。1 バイト以上が送信された場合、これ以上のバイトに応答は送信されず、デバイスは無効と判断して I2C メッセージを無視します。
5. データ (**0x06**) の **1** バイトが送信されると、コントローラはソフトウェア・リセット・シーケンスを終了させるために **STOP** 条件を送信します。**START** 条件が繰り返し送信されてもデバイスは無視し、リセットは実行されません。

上記の手順がすべて成功すると、デバイスはリセットを実行します。これにより、すべてのレジスタ値はクリアされ、電源オン時のデフォルト値に戻ります。

7.4 デバイスの機能モード

7.4.1 パワーオン・リセット

V_{CCP} に電力 ($0V \sim$) を印加すると、内部のパワーオン・リセットにより電源供給が V_{POR} に到達するまで TCAL6408 はリセット状態に保持されます。このとき、リセット状態は解除され、TCAL6408 のレジスタと I²C/SMBus のステート・マシンはそれぞれのデフォルト状態に初期化されます。その後、 V_{CCP} を V_{PORF} 未満に下げて、再びパワーリセット・サイクルの動作電圧まで戻す必要があります。

7.5 プログラミング

7.5.1 I²C インターフェイス

双方向 I²C バスは、シリアル・クロック (SCL) ラインとシリアル・データ (SDA) ラインで構成されます。デバイスの出力段に接続するときは、両方のラインをプルアップ抵抗経由で正の電源に接続する必要があります。データ転送は、バスがビジー状態でないときのみ開始できます。

このデバイスとの I²C 通信は、START 条件を送信するコントローラによって開始されます。START 条件は、SCL 入力が高レベルのときに、SDA 入力 / 出力が高レベルから低レベルに遷移することです (図 7-4 を参照)。START 条件の後、デバイスのアドレス・バイトが送信されます。最初は、データ方向ビット (R/W) を含む最上位ビット (MSB) が最初に送信されます。

有効なアドレス・バイトを受信すると、このデバイスは、ACK 関連のクロック・パルスが高レベルのときに SDA 入力 / 出力を低レベルにするアクノリッジ (ACK) で応答します。レスポンス・デバイスのアドレス入力を START 条件と STOP 条件の間で変更することはできません。

I²C バスでは、各クロック・パルスの間に 1 つのデータ・ビットのみが転送されます。SDA ラインのデータは、クロック周期の高レベルパルス中は安定している必要があります。この時点でデータ・ラインが変化すると、制御コマンド (START または STOP) として解釈されるためです (図 7-5 を参照)。

STOP 条件は、SCL 入力が高レベルのときに SDA 入力 / 出力が低レベルから高レベルに遷移することで、コントローラから送信されます (図 7-4 を参照)。

START 条件と STOP 条件の間に、トランスミッタからレシーバへ任意の数のデータ・バイトを転送できます。8 ビットの各バイトの後に 1 つの ACK ビットが続きます。レシーバが ACK ビットを送信する前に、トランスミッタは SDA ラインを解放

する必要があります。アクリッジを行うデバイスは、ACK 関連のクロック周期が High パルスのときは SDA ラインが安定して Low を維持できるように、ACK クロック・パルスの間は SDA ラインをプルダウンする必要があります (図 7-6 を参照)。レスポンドのレシーバがアドレス指定されている場合、各バイトを受信した後に ACK を生成する必要があります。同様に、コントローラはレスポンドのトランスミッタから受信した各バイトの後に ACK を生成する必要があります。適切な動作のためには、セットアップ時間とホールド時間の条件を満たす必要があります。

コントローラのレシーバは、最後のバイトがレスポンドからクロック出力された後、アクリッジ (NACK) を生成せずに、データの終了をレスポンドのトランスミッタに通知します。これは、コントローラのレシーバで SDA ラインを High に保持することにより行われます。この場合、コントローラが STOP 条件を生成できるように、トランスミッタはデータ・ラインを解放する必要があります。

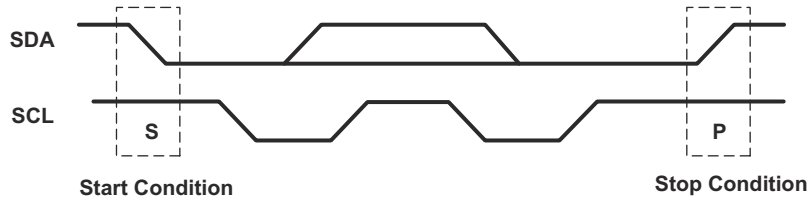


図 7-4. START 条件と STOP 条件の定義

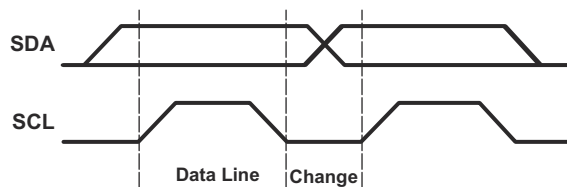


図 7-5. ビット転送

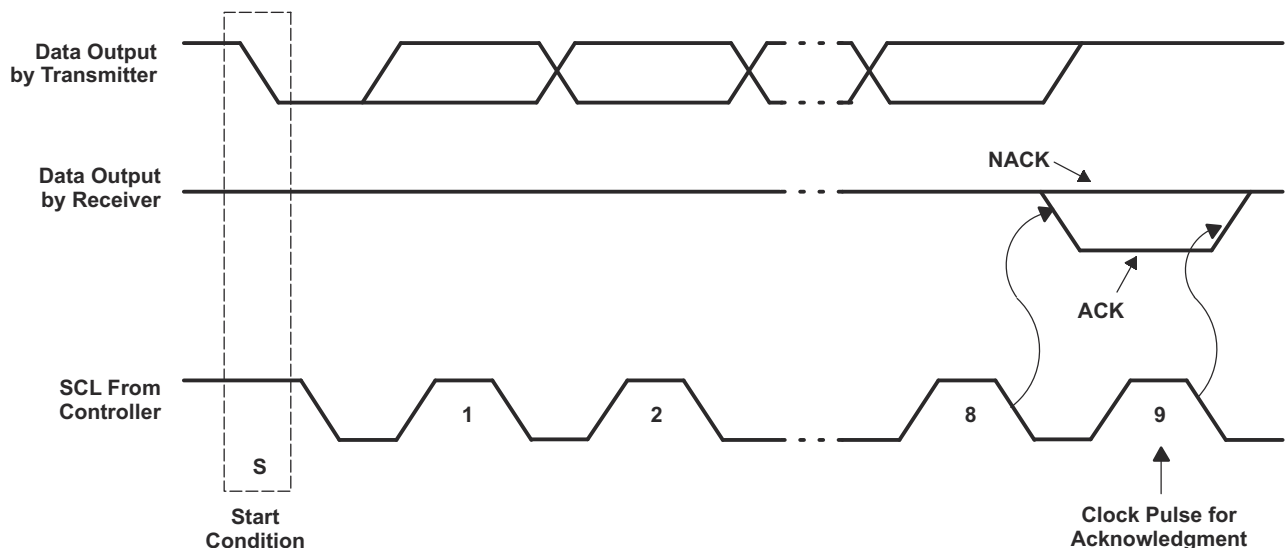


図 7-6. I²C バスのアクリッジ

表 7-2. インターフェイスの定義

バイト	ビット							
	7 (MSB)	6	5	4	3	2	1	0 (LSB)
デバイスの I ² C アドレス	L	H	L	L	L	L	ADDR	R/W
I/O データ・バス	P7	P6	P5	P4	P3	P2	P1	P0

7.6 レジスタ・マップ

7.6.1 デバイス・アドレス

TCAL6408 のアドレスを [図 7-7](#) に示します。

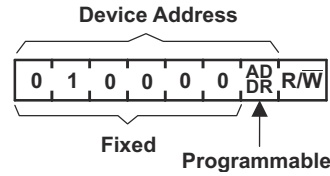


図 7-7. TCAL6408 のアドレス

表 7-3. アドレス参照

ADDR	I ² C バスのレスポンドのアドレス
L	32 (10 進)、20 (16 進)
H	33 (10 進)、21 (16 進)

レスポンドのアドレスの最後のビットにより、実行する動作 (読み取りまたは書き込み) が定義されます。High (1) を選択すると読み取り動作、Low (0) を選択すると書き込み動作となります。

7.6.2 制御レジスタとコマンド・バイト

アドレス・バイトのアクノリッジが成功すると、バス・コントローラはコマンド・バイトを送信します。このバイトは TCAL6408 の制御レジスタに保存されます。このデータ・バイトの下位 2 ビットは、影響を受ける内部レジスタ (入力、出力、極性反転、または構成) を反映しています。ビット 6 とコマンド・バイトの下位 3 ビットを組み合わせ使用し、デバイスの拡張機能 (Agile IO) を示します。コマンド・バイトは、書き込み転送中のみ送信されます。

新しいコマンドが送信されると、アドレス指定されたレジスタは、新しいコマンド・バイトが送信されるまで、読み取りによってアクセスが継続されます。電源投入時、ハードウェア・リセット時、またはソフトウェア・リセット時に、制御レジスタはデフォルトで 00h に設定されます。

B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
----	----	----	----	----	----	----	----

図 7-8. 制御レジスタ・ビット

表 7-4. コマンド・バイト

制御レジスタ・ビット								コマンド・バイト (16 進)	レジスタ	プロトコル	電源オン のデフォルト
B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0				
0	0	0	0	0	0	0	0	00	入力ポート	読み取りバイト	xxxx xxxx
0	0	0	0	0	0	0	1	01	出力ポート	読み取り / 書き込みバイト	1111 1111
0	0	0	0	0	0	1	0	02	極性反転	読み取り / 書き込みバイト	0000 0000
0	0	0	0	0	0	1	1	03	構成	読み取り / 書き込みバイト	1111 1111
0	1	0	0	0	0	0	0	40	出力駆動強度 0	読み取り / 書き込みバイト	1111 1111
0	1	0	0	0	0	0	1	41	出力駆動強度 1	読み取り / 書き込みバイト	1111 1111
0	1	0	0	0	0	1	0	42	入力ラッチ・レジスタ	読み取り / 書き込みバイト	0000 0000
0	1	0	0	0	0	1	1	43	プルアップ / プルダウン・イネーブル・レジスタ	読み取り / 書き込みバイト	0000 0000
0	1	0	0	0	1	0	0	44	プルアップ / プルダウン選択レジスタ	読み取り / 書き込みバイト	1111 1111
0	1	0	0	0	1	0	1	45	割り込みマスク・レジスタ	読み取り / 書き込みバイト	1111 1111
0	1	0	0	0	1	1	0	46	割り込みステータス・レジスタ	読み取りバイト	0000 0000
0	1	0	0	1	1	1	1	4F	出力ポート構成レジスタ	読み取り / 書き込みバイト	0000 0000

7.6.3 レジスタの説明

Input Port レジスタ (レジスタ 0) には、ピンが構成レジスタによって入力と出力のどちらに定義されているかに関係なく、ピンに入ってくるロジック・レベルが反映されます。Input Port レジスタは読み取り専用です。このレジスタに書き込みを行っても、影響はありません。デフォルト値 (X) は、外部で印加されるロジック・レベルによって決まります。読み取り動作の前に、書き込み転送が送信され、それと同時に、次に Input Port レジスタがアクセスされることを I²C デバイスに通知するコマンド・バイトも送信されます。

表 7-5. レジスタ 0 (Input Port レジスタ)

ビット	I-7	I-6	I-5	I-4	I-3	I-2	I-1	I-0
デフォルト	X	X	X	X	X	X	X	X

Output Port レジスタ (レジスタ 1) には、構成レジスタで出力として定義されているピンから出ていくロジック・レベルが示されます。このレジスタのビット値は、入力として定義されたピンには影響を与えません。反対に、このレジスタから読み出した値は、実際のピンの値ではなく、出力選択を制御しているフリップフロップの値に反映されます。

表 7-6. レジスタ 1 (Output Port レジスタ)

ビット	O-7	O-6	O-5	O-4	O-3	O-2	O-1	O-0
デフォルト	1	1	1	1	1	1	1	1

Polarity Inversion レジスタ (レジスタ 2) は、Configuration レジスタで入力として定義されたピンの極性を反転することができます。このレジスタのビットが設定されると (「1」を書き込む)、対応するポート・ピンの極性は反転します。このレジスタのビットがクリアされると (「0」を書き込む)、対応するポート・ピンの元の極性が保持されます。

表 7-7. レジスタ 2 (Polarity Inversion レジスタ)

ビット	P-7	P-6	P-5	P-4	P-3	P-2	P-1	P-0
デフォルト	0	0	0	0	0	0	0	0

Configuration レジスタ (レジスタ 3) は、I/O ピンの方向を構成します。このレジスタのビットを 1 に設定すると、対応するポート・ピンは高インピーダンス出力ドライバを持つ入力としてイネーブルになります。このレジスタのビットを 0 にクリアすると、対応するポート・ピンは出力としてイネーブルになります。

表 7-8. レジスタ 3 (Configuration レジスタ)

ビット	C-7	C-6	C-5	C-4	C-3	C-2	C-1	C-0
デフォルト	1	1	1	1	1	1	1	1

Output Drive Strength レジスタは、P ポートの GPIO バッファの出力駆動レベルを制御します。各 GPIO は、2 つのレジスタの制御ビットを使用して、目標の出力電流レベルに個別に構成することができます。たとえば、ポート P07 はレジスタ 41 (ビット 7 および 6) で制御され、ポート P06 はレジスタ 41 (ビット 5 および 4) で制御され、以下も同様です。GPIO の出力駆動レベルは、00b = 0.25x の駆動強度、01b = 0.5x の駆動強度、10b = 0.75x の駆動強度、11b = 完全駆動強度の能力を持つ 1x にプログラムされます。

表 7-9. レジスタ 40 および 41 (Output Drive Strength レジスタ)

ビット	CC-3	CC-3	CC-2	CC-2	CC-1	CC-1	CC-0	CC-0
デフォルト	1	1	1	1	1	1	1	1
ビット	CC-7	CC-7	CC-6	CC-6	CC-5	CC-5	CC-4	CC-4
デフォルト	1	1	1	1	1	1	1	1

Input Latch レジスタは、P ポートの GPIO ピンの入力ラッチ機能をイネーブル / ディセーブルにします。このレジスタは、ピンが入力ポートとして構成されている場合にのみ有効です。Input Latch レジスタ・ビットが 0 のとき、対応する入力ピンの状態はラッチされません。対応する入力ピンの状態が変化すると、割り込みが発生します。入力レジスタの読み出しを行うと、割り込みはクリアされます。入力が最初のロジック状態に戻ってから、Input Port レジスタを読み出すと、割り込みはクリアされます。

Input Latch レジスタ・ビットが 1 にセットされると、対応する入力ピンの状態がラッチされます。入力状態が変化すると、割り込みが発生し、入力ロジック値が Input Port レジスタ (レジスタ 0 および 1) の対応ビットにロードされます。Input Port レジスタを読み出すと、割り込みはクリアされます。ただし、Input Port レジスタを読み出す前に、入力ピンが元のロジック状態に戻ると、割り込みはクリアされず、Input Port レジスタの対応するビットには割り込みが開始されたロジック値が保持されます。

たとえば、P4 入力がロジック 0 状態にあり、それからロジック 1 状態に遷移して、再びロジック 0 状態に戻ると、Input Port レジスタはこの変化を捉えて、割り込みが生成されます (マスクされていない場合)。Input Port 0 レジスタで読み取り

が実行されると、割り込みはクリアされ、それ以降で変化した入力はなかったとみなされ、Input Port レジスタのビット 4 は「1」を読み出します。Input Port レジスタのビット 4 の次の読み出し値は、この時点で「0」になります。

ラッチされていない入力とラッチされた入力の状態が同時に切り替わり、それから元の状態に戻ると、割り込みはアクティブのままとなります。入力レジスタを読み出すと、ラッチされた入力の状態変化のみが反映され、割り込みもクリアされず。Input Latch レジスタがラッチされた構成からラッチされていない構成に変わると、入力のロジック値が元の状態に戻るタイミングで、割り込みはクリアされます。

入力ピンがラッチされた入力からラッチされていない入力に変わると、Input Port レジスタからの読み出しには、現在のポート・ロジック・レベルが反映されます。入力ピンがラッチされていない入力からラッチされた入力に変わると、入力レジスタからの読み出しにはラッチされたロジック・レベルが反映されます。

表 7-10. レジスタ 42 (Input Latch レジスタ)

ビット	L-7	L-6	L-5	L-4	L-3	L-2	L-1	L-0
デフォルト	0	0	0	0	0	0	0	0

Pull-Up/Pull-Down Enable レジスタを使用すると、GPIO ピンのプルアップ / プルダウン抵抗をイネーブル / ディセーブルにすることができます。ビットをロジック 1 にセットすると、プルアップ / プルダウン抵抗を選択することができます。ビットをロジック 0 にセットすると、GPIO ピンからプルアップ / プルダウン抵抗を切断します。GPIO を出力として構成すると、抵抗はディセーブルになります。Pull-Up/Pull-Down Selection レジスタを使用すると、プルアップ抵抗またはプルダウン抵抗のいずれかを選択することができます。

表 7-11. レジスタ 43 (Pull-Up/Pull-Down Enable レジスタ)

ビット	PE-7	PE-6	PE-5	PE-4	PE-3	PE-2	PE-1	PE-0
デフォルト	0	0	0	0	0	0	0	0

Pull-Up/Pull-Down Selection レジスタを使用すると、それぞれのレジスタ・ビットをプログラムすることにより、各 GPIO のプルアップ抵抗やプルダウン抵抗を構成することができます。ビットをロジック 1 にセットすると、その GPIO ピンに対して 100kΩ のプルアップ抵抗が選択されます。ビットをロジック 0 にセットすると、その GPIO ピンに対して 100kΩ のプルダウン抵抗が選択されます。レジスタ 43 を使用してプルアップ / プルダウン機能をディセーブルにすると、これらのレジスタに書き込みを行っても GPIO ピンに影響はありません。

表 7-12. レジスタ 44 (Pull-Up/Pull-Down Selection レジスタ)

ビット	PUD-7	PUD-6	PUD-5	PUD-4	PUD-3	PUD-2	PUD-1	PUD-0
デフォルト	1	1	1	1	1	1	1	1

電源オン時には、Interrupt Mask レジスタはデフォルトのロジック 1 にセットされ、システムの起動時は割り込みはディセーブルになります。割り込みをイネーブルにするには、対応するマスク・ビットをロジック 0 にセットします。

入力状態が変化し、Interrupt Mask レジスタの対応ビットが 1 になると、割り込みはマスクされ、割り込みピンはアサートされません。Interrupt Mask レジスタの対応ビットが 0 にセットされると、割り込みピンがアサートされます。

入力状態が変化し、その結果として割り込みがマスクされると、Interrupt Mask レジスタ・ビットを 0 にセットすることにより、割り込みピンがアサートされます。現時点ですでに割り込みのソースになっている入力の割り込みマスク・ビットが 1 にセットされると、割り込みピンのアサートは解除されます。

表 7-13. レジスタ 45 (Interrupt Mask レジスタ)

ビット	M-7	M-6	M-5	M-4	M-3	M-2	M-1	M-0
デフォルト	1	1	1	1	1	1	1	1

Interrupt Status レジスタは、割り込みのソースを識別するために使用する読み取り専用レジスタです。読み取り値がロジック 1 の場合、対応する入力ピンは割り込みのソースだったことを示しています。ロジック 0 の場合、入力ピンは割り込み

のソースではないことを示しています。Interrupt Mask レジスタの対応ビットが 1 にセットされると (マスクされる)、割り込みステータス・ビットはロジック 0 に戻ります。

表 7-14. レジスタ 46 (Interrupt Status レジスタ)

ビット	S-7	S-6	S-5	S-4	S-3	S-2	S-1	S-0
デフォルト	0	0	0	0	0	0	0	0

Output Port Configuration レジスタは、ポート単位でプッシュプルかオープン・ドレイン入出力段かを選択できます。ロジック 0 にセットすると、I/O をプッシュプルとして構成します (Q1 および Q2 はアクティブになります。図 7-2 を参照)。ロジック 1 にセットすると、I/O をオープン・ドレインとして構成します (Q1 はディセーブル、Q2 はアクティブ)。また、推奨コマンド・シーケンスは、Configuration レジスタ (03) でポート・ピンを出力としてセットする前に、このレジスタ (4F) をプログラムすることです。

表 7-15. レジスタ 4F (Output Port Configuration レジスタ)

ビット	予約済み							ODEN-0
デフォルト	0	0	0	0	0	0	0	0

7.6.4 バス・トランザクション

データは、書き込みおよび読み取りコマンドを使用して、コントローラと TCAL6408 の間で交換されます。

7.6.4.1 書き込み

TCAL6408 にデータを送信するには、デバイス・アドレスを送信して、最下位ビット (LSB) をロジック 0 にセットします (デバイス・アドレスについては、図 7-7 を参照)。アドレスの後にコマンド・バイトが送信され、コマンド・バイトの後ろのデータを受信するレジスタを指定します。1 回の書き込みで送信されるデータ・バイト数に制限はありません。

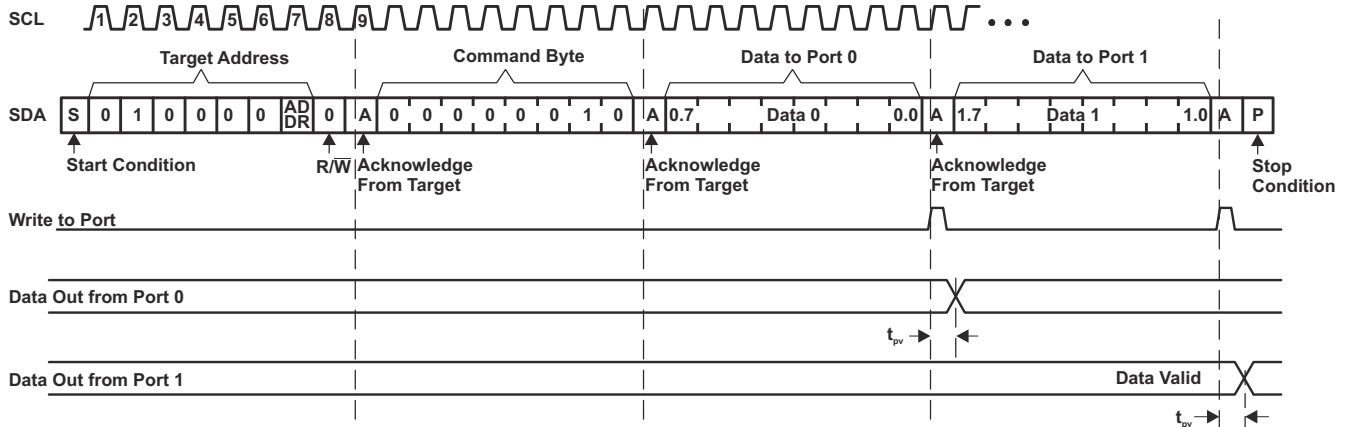


図 7-9. Output Port レジスタへの書き込み

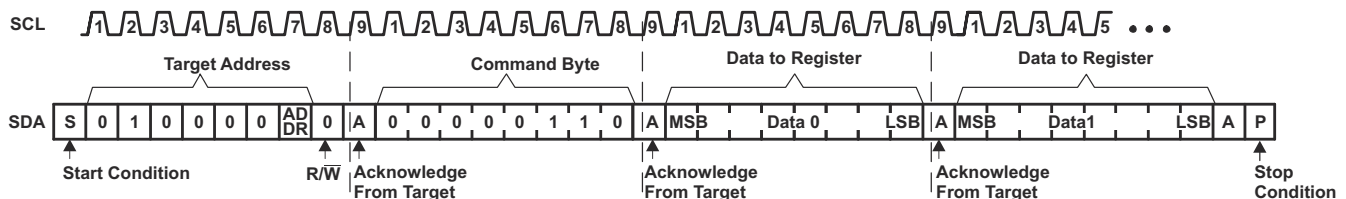


図 7-10. Configuration レジスタまたは Polarity Inversion レジスタへの書き込み

7.6.4.2 読み取り

バス・コントローラは最初に、ロジック 0 にセットした LSB を付加した TCAL6408 のアドレスを送信する必要があります (デバイスのアドレスについては 図 7-7 を参照)。アドレスの後に、コマンド・バイトを送信して、アクセスするレジスタを決定します。

データは、ACK クロック・パルスの立ち上がりエッジでレジスタに書き込まれます。1 回の読み出し転送で受信するデータ・バイト数に制限はありませんが、最後のバイトを受信するとき、バス・コントローラはデータに応答確認を返しません。

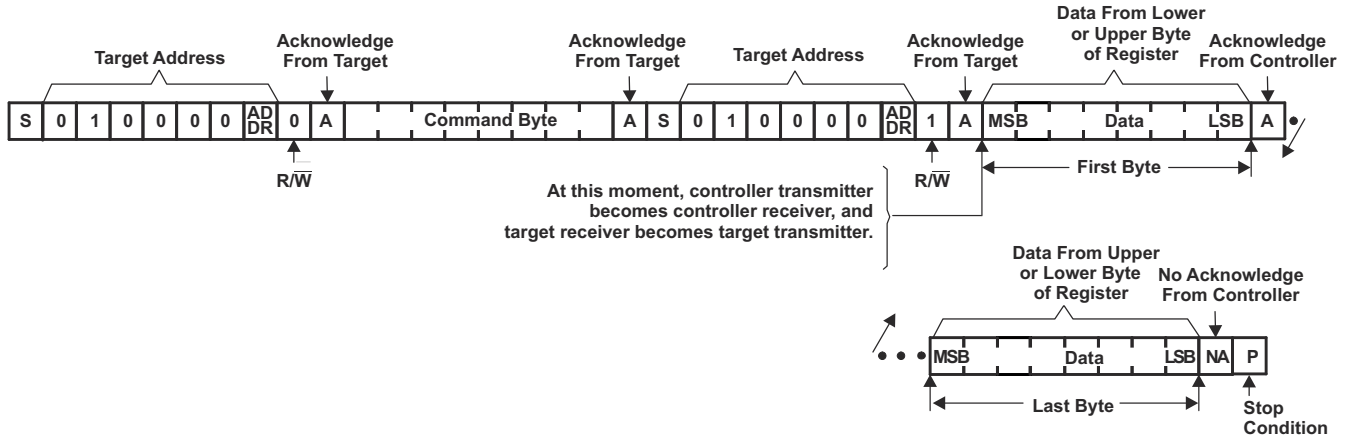
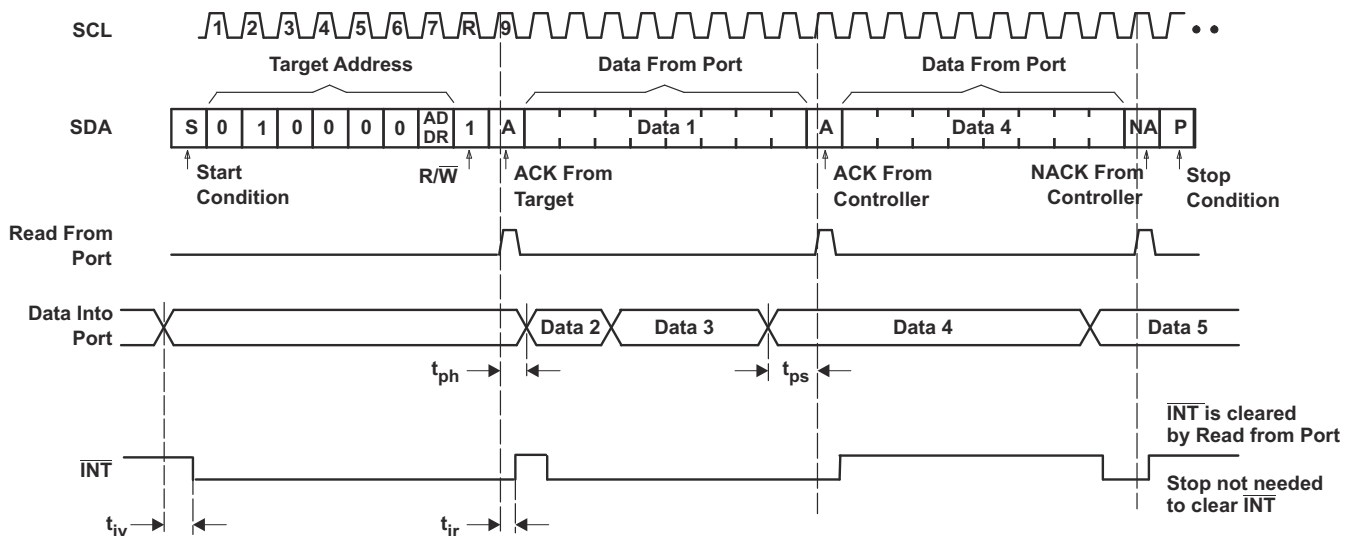


図 7-11. レジスタからの読み取り



- データの転送は、STOP 条件によりいつでも停止できます。このとき、最新のアクリッジ・フェーズに存在するデータが有効になります (出力モード)。これは、コマンド・バイトがここまでの時点で 00 (Input Port レジスタの読み取り) に設定されているものと想定しています。
- この図では、コマンド・バイト転送、再起動、および最初のレスポンス・アドレス呼び出しと P ポートから転送される実データとの間のレスポンス・アドレス呼び出しが除去されています (図 7-11 を参照)。

図 7-12. Input Port レジスタの読み取り

8 アプリケーションと実装

注

以下のアプリケーション情報は、テキサス・インスツルメンツの製品仕様に含まれるものではなく、テキサス・インスツルメンツはその正確性も完全性も保証いたしません。個々の目的に対する製品の適合性については、お客様の責任で判断していただくことになります。お客様は自身の設計実装を検証しテストすることで、システムの機能を確認する必要があります。

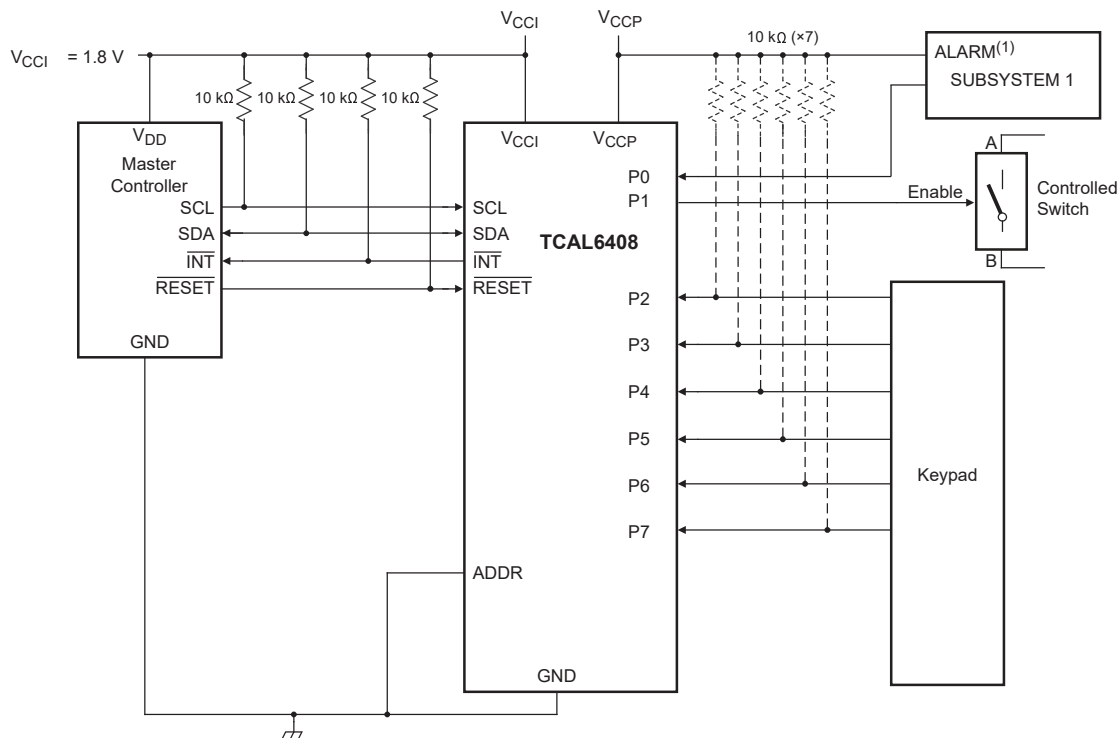
8.1 アプリケーション情報

TCAL6408 のアプリケーションでは、このデバイスを I2C コントローラ (プロセッサ) のレスポндаとして接続し、I2C バスには他の任意の数のレスポнда・デバイスを含めることができます。TCAL6408 はコントローラから離れた場所で、コントローラが監視または制御する必要のある GPIO の近くに配置されます。

TCAL6408 の代表的なアプリケーションは、コントローラ側の低いほうの電圧 (V_{CCI}) と P ポート側の高いほうの電圧 (V_{CCP}) で動作します。P ポートは、イネーブル、リセット、電源選択、スイッチのゲート、LED などのデバイスの入力に接続される出力として構成できます。P ポートは、割り込み、アラーム、ステータス出力、プッシュ・ボタンからデータを受信する入力として構成することもできます。

8.2 代表的なアプリケーション

図 8-1 に、TCAL6408 を使用可能なアプリケーションを示します。



- この例では、デバイス・アドレスを 0100000 に設定しています。
- P0 および P2~P7 は入力として構成されています。
- P1 は出力として構成されています。
- フローティングになる可能性のある (P ポート上の) 入力には抵抗が必要です。ドライバにより入力がフローティングにならないのであれば、抵抗は不要です。出力 (P ポート内) にプルアップ抵抗は不要です。

図 8-1. 代表的なアプリケーション回路図

8.2.1 設計要件

表 8-1. 設計パラメータ

設計パラメータ	値の例
I ² C 入力電圧 (V _{CCI})	1.8V
P ポートの入出力電圧 (V _{CCP})	3.6V
出力電流定格、P ポート・シンク (I _{OL})	25mA
出力電流定格、P ポート・ソース (I _{OH})	10mA
I ² C バス・クロック (SCL) 速度	1MHz

8.2.2 詳細な設計手順

SCL および SDA ラインのプルアップ抵抗 R_p は、I²C バス上のすべてのレスポндаの合計容量を考慮して、適切に選択する必要があります。最小プルアップ抵抗は、次のように V_{CCI}、V_{OL(max)}、I_{OL} の関数です。

$$R_{p(\min)} = \frac{V_{CCI} - V_{OL(\max)}}{I_{OL}} \quad (1)$$

最大プルアップ抵抗は、次のように最大立ち上がり時間 t_r (高速モード・プラス動作時は 120ns、f_{SCL} = 1MHz) とバス容量 C_b の関数です。

$$R_{p(\max)} = \frac{t_r}{0.8473 \times C_b} \quad (2)$$

I²C バスの最大バス容量は、標準モードまたは高速モード動作で 400pF、または高速モード・プラスで 550pF を超えないようにする必要があります。バス容量は、TCAL6408 の容量、SCL 用の C_i または SDA 用の C_{io}、配線 / 接続 / パターンの容量、バス上の追加レスポндаの容量を追加することで近似値を求めることができます。

8.2.2.1 I/O で LED を制御する場合の I_{CC} 最小化

I/O を使用して LED を制御する場合、通常は [図 8-2](#) に示すように抵抗を介して V_{CCP} に接続します。P ポートが入力として構成されている場合、V_I が V_{CCP} より小さくなるにつれて消費電流は大きくなります。LED はスレッシュホールド電圧 V_T のダイオードです。P ポートが入力として構成されている場合、LED はオフになりますが、V_I は V_{CCP} CC 以下に降下する V_T です。

バッテリー駆動のアプリケーションでは、P ポートが入力として構成され消費電流が最小限に抑えられている場合、LED を制御する P ポートの電圧は V_{CCP} と同じかそれ以上にする必要があります。[図 8-2](#) に、LED と並列に設置した値の大きな抵抗を示します。[図 8-3](#) に、少なくとも V_T によって、LED 供給電圧より小さくなる V_{CCP} を示します。この方法はどちらも、I/O の V_I を V_{CCP} と同じかそれ以上に維持するため、P ポートが入力として構成され LED がオフになった場合でも、消費電流の増加を防ぎます。

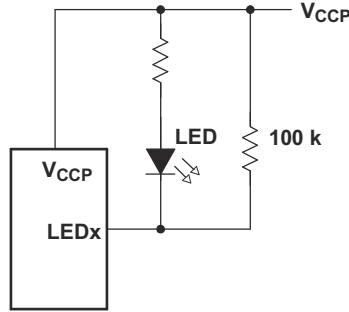


図 8-2. LED と並列に設置した値の大きな抵抗

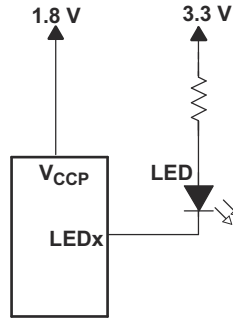
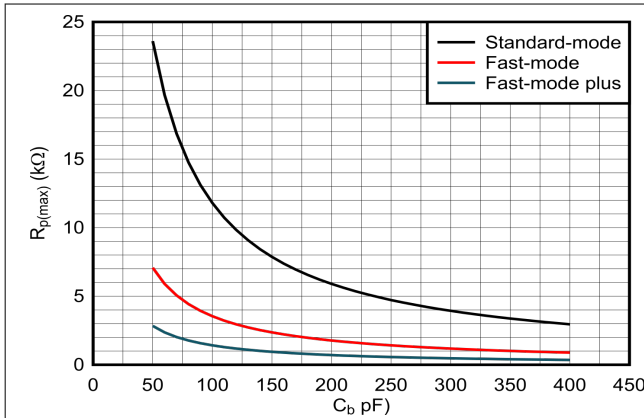


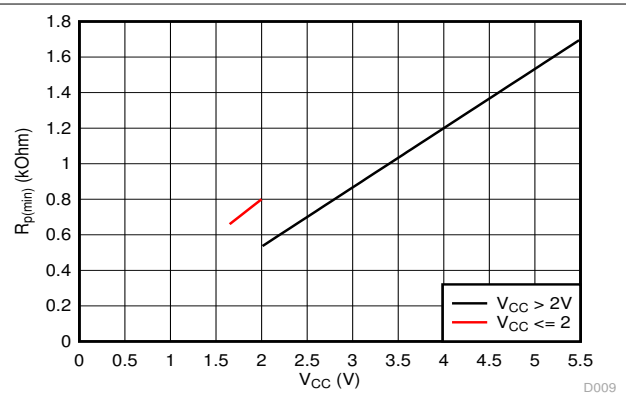
図 8-3. 低電圧で供給されるデバイス

8.2.3 アプリケーション曲線



標準モード: $f_{SCL} = 100\text{kHz}$, $t_r = 1\mu\text{s}$
 高速モード: $f_{SCL} = 400\text{kHz}$, $t_r = 300\text{ns}$

図 8-4. 最大プルアップ抵抗 ($R_{p(max)}$) とバス容量 (C_b) との関係



$V_{OL} = 0.2 \times V_{CC}$, $I_{OL} = 2\text{mA}$ ($V_{CC} \leq 2\text{V}$ の場合)
 $V_{OL} = 0.4\text{V}$, $I_{OL} = 3\text{mA}$ ($V_{CC} > 2\text{V}$)

図 8-5. 最小プルアップ抵抗 ($R_{p(min)}$) とプルアップ基準電圧 (V_{CC})

8.3 電源に関する推奨事項

8.3.1 パワーオン・リセットの要件

グリッチやデータ破損が発生した場合、パワーオン・リセット機能を使用して TCAL6408 をデフォルト状態にリセットできます。パワーオン・リセットを実行するには、デバイスを完全にリセットするためにパワー・サイクルを完了させる必要があります。このリセットは、アプリケーションでデバイスの電源を初めてオンにしたときにも発生します。

図 8-6 および 図 8-7 に、2 種類のパワーオン・リセットを示します。

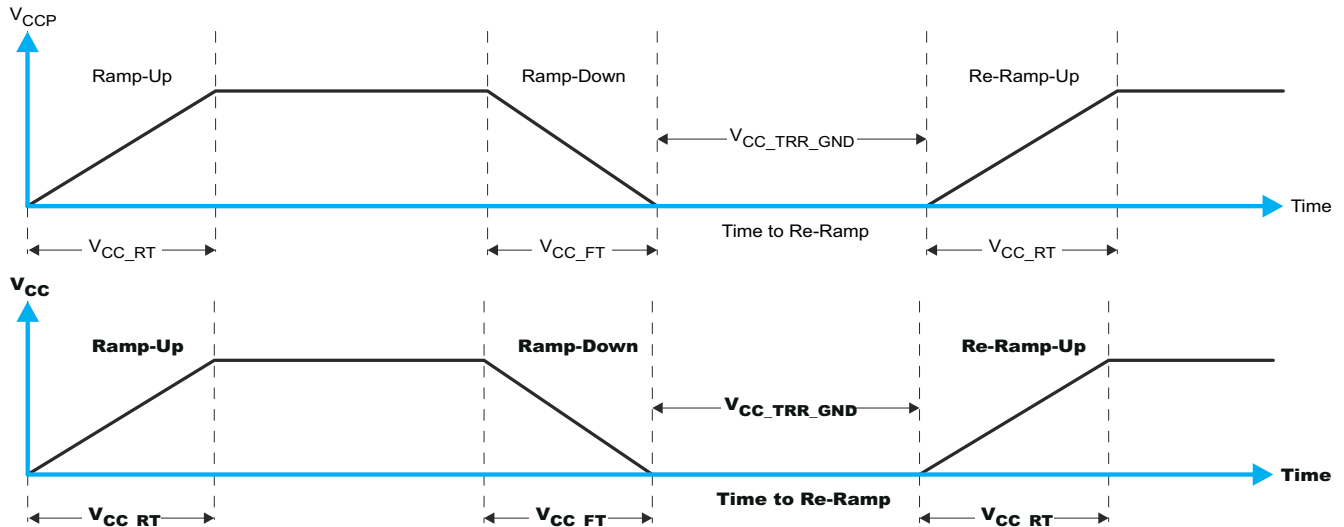


図 8-6. V_{CCP} は 0.2V を下回るまで低下するか、または 0V になり、その後増加します

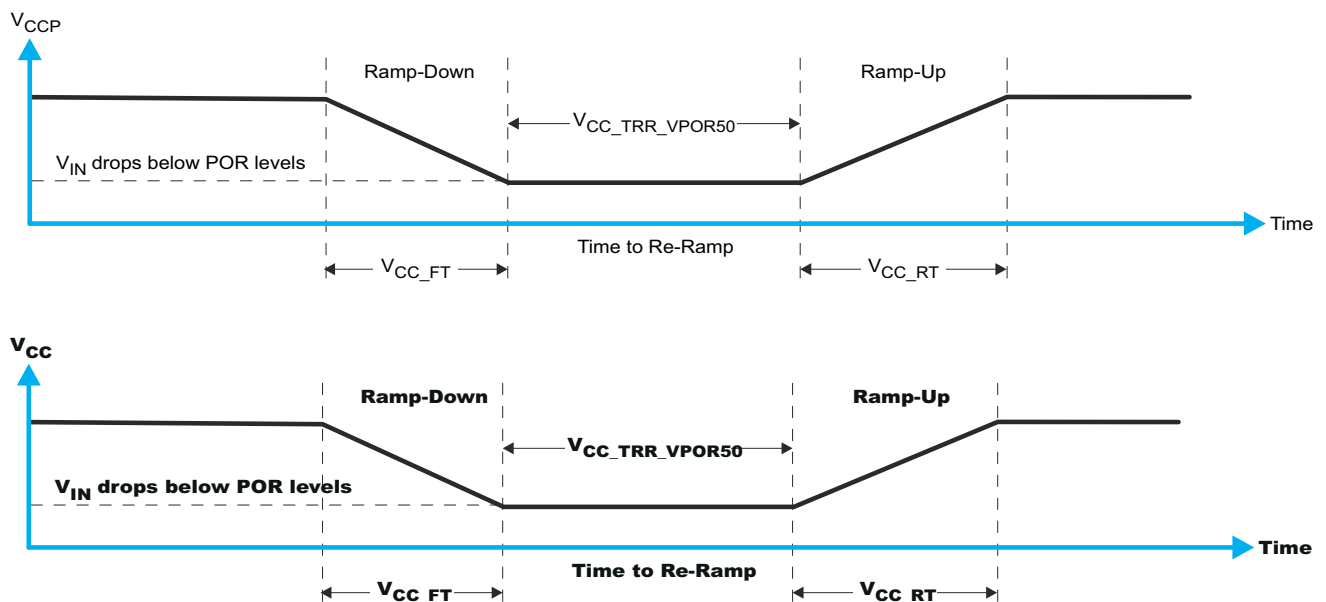


図 8-7. V_{CCP} は POR スレッシュホールドを下回るまで低下し、その後上昇して戻ります

表 8-2 に、両方のタイプのパワーオン・リセットについて、TCAL6408 のパワーオン・リセット機能の性能を規定します。

表 8-2. 推奨される電源シーケンシングとランプ・レート

パラメータ(1) (2)			最小値	標準値	最大値	単位
t_{FT}	立ち下がりレート	図 8-6 を参照	0.1		2000	ms
t_{RT}	立ち上がりレート	図 8-6 を参照	0.1		2000	ms
t_{TRR_GND}	再ランプ時間 (V_{CC} が GND まで低下する場合)	図 8-6 を参照	1			μ s
t_{TRR_POR50}	再ランプ時間 (V_{CC} が $V_{POR_MIN} - 50$ mV まで低下する場合)	図 8-7 を参照	1			μ s
V_{CC_GH}	V_{CCP} にグリッチが発生することはあるが、 $V_{CCP_GW} = 1\mu$ s のときに機能が途絶しないレベル	図 8-8 を参照			1.0	V
t_{GW}	$V_{CCP_GH} = 0.5 \times V_{CCx}$ のときに、機能が途絶しないグリッチ幅	図 8-8 を参照			10	μ s
V_{PORF}	V_{CC} 立ち下がり時の POR の電圧トリップ・ポイント		0.6			V
V_{PORR}	V_{CC} 立ち上がり時の POR の電圧トリップ・ポイント				1.0	V

- (1) $T_A = 25^\circ\text{C}$ (特に記述のない限り)。
(2) 未テスト。設計により規定されています。

電源のグリッチは、このデバイスのパワーオン・リセット性能にも影響を及ぼす可能性があります。グリッチ幅 (V_{CC_GW}) と高さ (V_{CC_GH}) は互いに依存します。バイパス容量、ソース・インピーダンス、デバイス・インピーダンスは、パワーオン・リセット性能に影響を及ぼす要因です。これらの仕様を測定する方法の詳細については、図 8-8 と表 8-2 を参照してください。

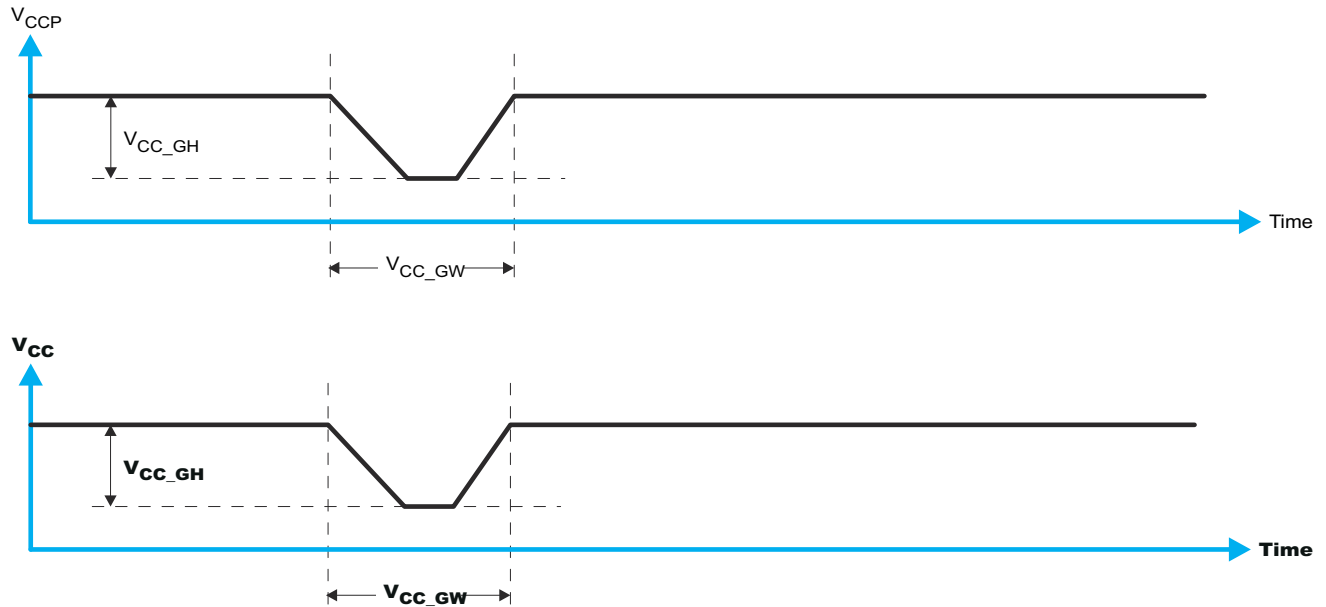


図 8-8. グリッチ幅とグリッチ高さ

V_{POR} は、パワーオン・リセットに不可欠です。 V_{POR} は、リセット条件が解放され、すべてのレジスタと $I^2C/SMBus$ ステータス・マシンがデフォルト状態に初期化される電圧レベルです。 V_{POR} の値は、0 に低下するか、または 0 から低下した V_{CCP} に応じて変わります。図 8-9 と表 8-2 で、この仕様の詳細について説明します。

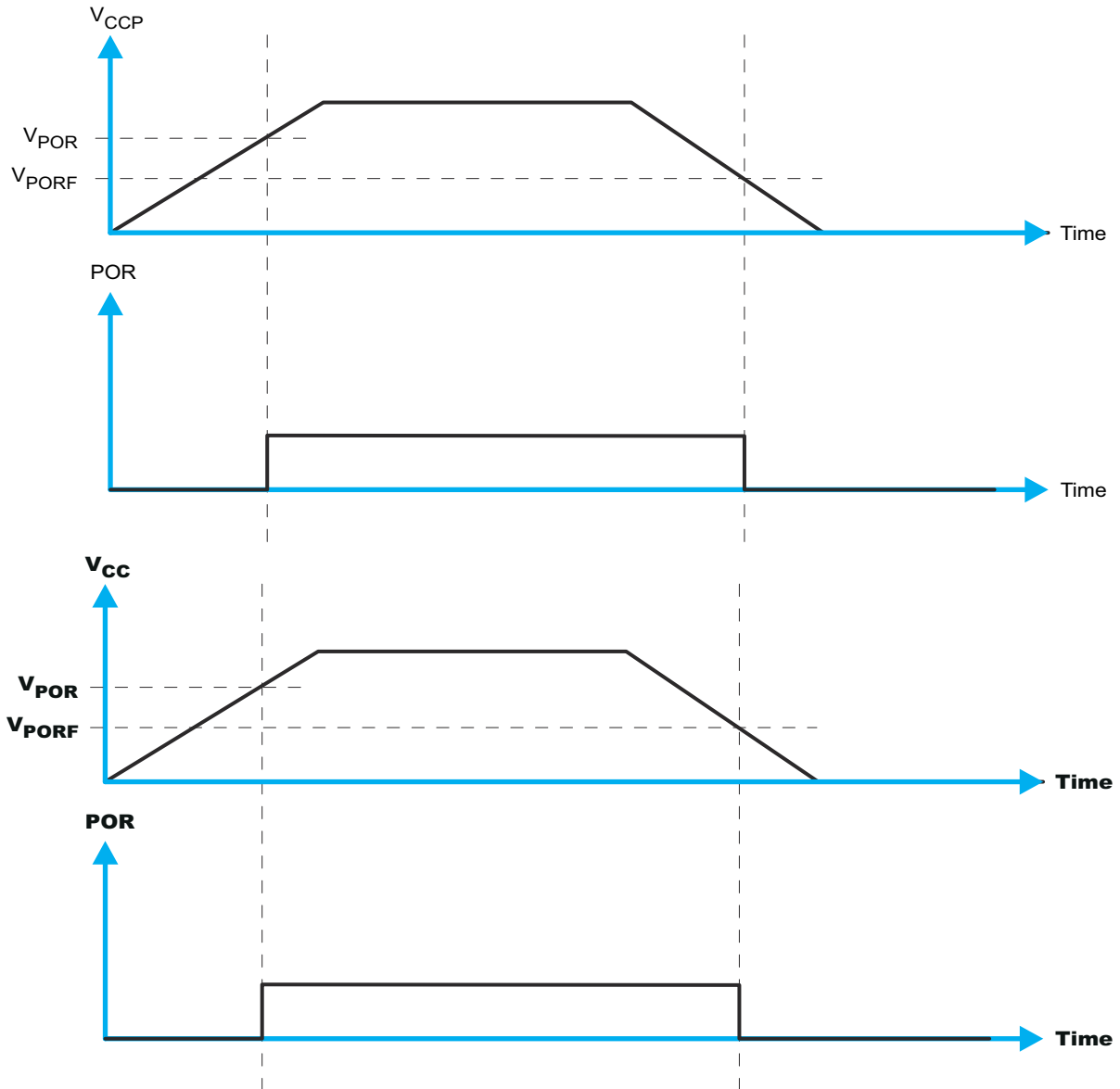


図 8-9. V_{POR}

8.4 レイアウト

8.4.1 レイアウトのガイドライン

TCAL6408 のプリント回路基板 (PCB) レイアウトでは、一般的な PCB レイアウトの慣例に従う必要がありますが、適合したインピーダンスや差動ペアなどの高速データ転送は、I²C 信号速度では大きな問題にはなりません。

すべての PCB レイアウトにおける最善策は、信号トレースで適切な角度を回避すること、集積回路 (IC) の近接部を離れるときに信号トレースが互いに離れていくように配置すること、トレース幅を太くして電源とグラウンドのトレースを通常時に大容量の電流が流れるようにすることです。バイパス・コンデンサとデカップリング・コンデンサは、一般的に電源ピンの電圧の制御に使用されます。大容量コンデンサを使用すると、電源グリッチの短絡時に追加電力を供給し、容量の小さいコンデンサは高周波リップルの除去を行うことができます。これらのコンデンサは、できる限り TCAL6408 の近くに配置してください。理想的な配置を 図 8-10 に示します。

図 8-10 に示すレイアウト例では、信号配線に最上層を使用し、電源とグラウンド (GND) に分割プレーンとして最下層を使用することで、2 層のみの PCB を製造することができます。ただし、信号配線密度の高い基板では、4 層基板が推奨されます。一般的に 4 層 PCB では、信号を最上層と最下層に配線し、内部の 1 層をグラウンド・プレーン専用にして、もう 1 つの内部層を電源プレーン専用にします。電源とグラウンドにプレーンまたは分割プレーンを使用する基板レイアウトの場合は、電源または GND に接続する必要がある表面実装部品パッドのすぐ隣にビアを配置し、ビアを内部層または基板の反対側に電気的に接続します。ビアは、信号パターンを基板の反対側に配線する必要がある場合にも使用されますが、この方法は 図 8-10 には示されていません。

8.4.2 レイアウト例

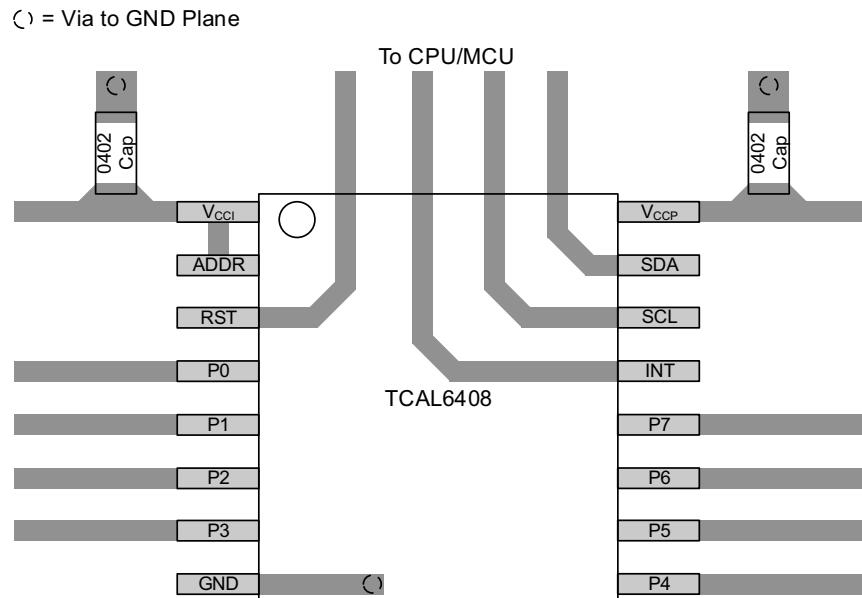


図 8-10. TCAL6408 のレイアウト

9 デバイスおよびドキュメントのサポート

9.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法

ドキュメントの更新についての通知を受け取るには、ti.com のデバイス製品フォルダを開いてください。「更新の通知を受け取る」をクリックして登録すると、変更されたすべての製品情報に関するダイジェストを毎週受け取れます。変更の詳細については、修正されたドキュメントに含まれている改訂履歴をご覧ください。

9.2 サポート・リソース

TI E2E™ サポート・フォーラムは、エンジニアが検証済みの回答と設計に関するヒントをエキスパートから迅速かつ直接得ることができる場所です。既存の回答を検索したり、独自の質問をしたりすることで、設計に必要な支援を迅速に得ることができます。

リンクされているコンテンツは、該当する貢献者により、現状のまま提供されるものです。これらは TI の仕様を構成するものではなく、必ずしも TI の見解を反映したものではありません。TI の[使用条件](#)を参照してください。

9.3 商標

TI E2E™ is a trademark of Texas Instruments.

すべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

9.4 静電気放電に関する注意事項



この IC は、ESD によって破損する可能性があります。テキサス・インスツルメンツは、IC を取り扱う際には常に適切な注意を払うことを推奨します。正しい取り扱いおよび設置手順に従わない場合、デバイスを破損するおそれがあります。

ESD による破損は、わずかな性能低下からデバイスの完全な故障まで多岐にわたります。精密な IC の場合、パラメータがわずかに変化するだけで公表されている仕様から外れる可能性があるため、破損が発生しやすくなっています。

9.5 用語集

[テキサス・インスツルメンツ用語集](#)

この用語集には、用語や略語の一覧および定義が記載されています。

10 改訂履歴

資料番号末尾の英字は改訂を表しています。その改訂履歴は英語版に準じています。

Changes from Revision A (December 2022) to Revision B (November 2023)	Page
• 「製品情報」表を「パッケージ情報」表に変更製品プレビューの注を削除.....	1

Changes from Revision * (November 2022) to Revision A (December 2022)	Page
• ドキュメントのステータスを:「事前情報」から「量産データ」に変更.....	1

11 メカニカル、パッケージ、および注文情報

以降のページには、メカニカル、パッケージ、および注文に関する情報が記載されています。この情報は、指定のデバイスについて利用可能な最新のデータです。このデータは予告なく変更されることがあり、ドキュメントが改訂される場合もあります。本データシートのブラウザ版を使用されている場合は、画面左側の説明をご覧ください。

PACKAGING INFORMATION

Orderable Device	Status (1)	Package Type	Package Drawing	Pins	Package Qty	Eco Plan (2)	Lead finish/ Ball material (6)	MSL Peak Temp (3)	Op Temp (°C)	Device Marking (4/5)	Samples
TCAL6408DTUR	ACTIVE	X2QFN	DTU	16	3000	RoHS & Green	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	NG	Samples
TCAL6408PWR	ACTIVE	TSSOP	PW	16	3000	RoHS & Green	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	TL6408	Samples
TCAL6408RSVR	ACTIVE	UQFN	RSV	16	3000	RoHS & Green	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	6408	Samples

(1) The marketing status values are defined as follows:

ACTIVE: Product device recommended for new designs.

LIFEBUY: TI has announced that the device will be discontinued, and a lifetime-buy period is in effect.

NRND: Not recommended for new designs. Device is in production to support existing customers, but TI does not recommend using this part in a new design.

PREVIEW: Device has been announced but is not in production. Samples may or may not be available.

OBSOLETE: TI has discontinued the production of the device.

(2) **RoHS:** TI defines "RoHS" to mean semiconductor products that are compliant with the current EU RoHS requirements for all 10 RoHS substances, including the requirement that RoHS substance do not exceed 0.1% by weight in homogeneous materials. Where designed to be soldered at high temperatures, "RoHS" products are suitable for use in specified lead-free processes. TI may reference these types of products as "Pb-Free".

RoHS Exempt: TI defines "RoHS Exempt" to mean products that contain lead but are compliant with EU RoHS pursuant to a specific EU RoHS exemption.

Green: TI defines "Green" to mean the content of Chlorine (Cl) and Bromine (Br) based flame retardants meet JS709B low halogen requirements of <=1000ppm threshold. Antimony trioxide based flame retardants must also meet the <=1000ppm threshold requirement.

(3) MSL, Peak Temp. - The Moisture Sensitivity Level rating according to the JEDEC industry standard classifications, and peak solder temperature.

(4) There may be additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category on the device.

(5) Multiple Device Markings will be inside parentheses. Only one Device Marking contained in parentheses and separated by a "~" will appear on a device. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire Device Marking for that device.

(6) Lead finish/Ball material - Orderable Devices may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.

Important Information and Disclaimer:The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.

TAPE AND REEL INFORMATION

QUADRANT ASSIGNMENTS FOR PIN 1 ORIENTATION IN TAPE


*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Reel Diameter (mm)	Reel Width W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)	Pin1 Quadrant
TCAL6408DTUR	X2QFN	DTU	16	3000	180.0	9.5	1.75	1.75	0.5	4.0	8.0	Q1
TCAL6408PWR	TSSOP	PW	16	3000	330.0	12.4	6.9	5.6	1.6	8.0	12.0	Q1
TCAL6408RSVR	UQFN	RSV	16	3000	178.0	13.5	2.1	2.9	0.75	4.0	12.0	Q1

TAPE AND REEL BOX DIMENSIONS


*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)
TCAL6408DTUR	X2QFN	DTU	16	3000	189.0	185.0	36.0
TCAL6408PWR	TSSOP	PW	16	3000	356.0	356.0	35.0
TCAL6408RSVR	UQFN	RSV	16	3000	189.0	185.0	36.0



4220204/A 02/2017

NOTES:

1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0.15 mm per side.
4. This dimension does not include interlead flash. Interlead flash shall not exceed 0.25 mm per side.
5. Reference JEDEC registration MO-153.

EXAMPLE BOARD LAYOUT

PW0016A

TSSOP - 1.2 mm max height

SMALL OUTLINE PACKAGE



LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE: 10X



SOLDER MASK DETAILS

4220204/A 02/2017

NOTES: (continued)

- 6. Publication IPC-7351 may have alternate designs.
- 7. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.

EXAMPLE STENCIL DESIGN

PW0016A

TSSOP - 1.2 mm max height

SMALL OUTLINE PACKAGE



SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL
SCALE: 10X

4220204/A 02/2017

NOTES: (continued)

8. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
9. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

GENERIC PACKAGE VIEW

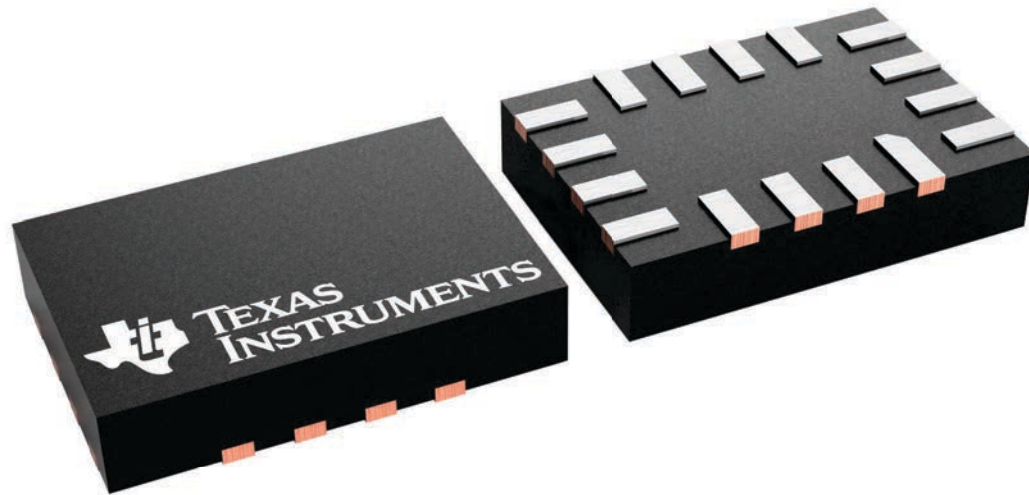
RSV 16

UQFN - 0.55 mm max height

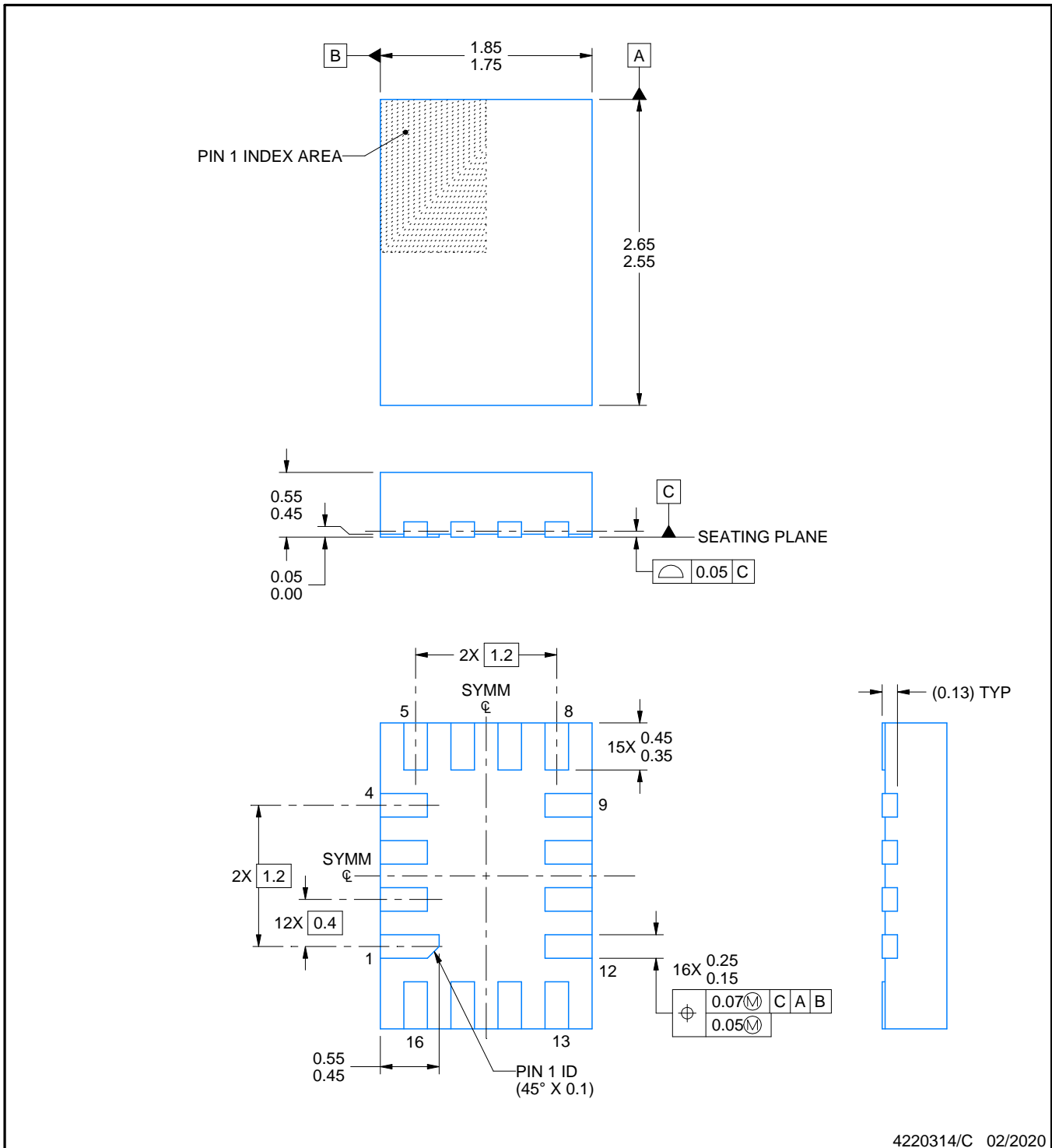
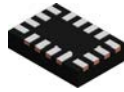
1.8 x 2.6, 0.4 mm pitch

ULTRA THIN QUAD FLATPACK - NO LEAD

This image is a representation of the package family, actual package may vary.
Refer to the product data sheet for package details.



4231225/A



4220314/C 02/2020

NOTES:

1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.

EXAMPLE BOARD LAYOUT

RSV0016A

UQFN - 0.55 mm max height

ULTRA THIN QUAD FLATPACK - NO LEAD



LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE: 25X



4220314/C 02/2020

NOTES: (continued)

3. For more information, see Texas Instruments literature number SLUA271 (www.ti.com/lit/slua271).

EXAMPLE STENCIL DESIGN

RSV0016A

UQFN - 0.55 mm max height

ULTRA THIN QUAD FLATPACK - NO LEAD



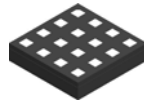
SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 MM THICK STENCIL
SCALE: 25X

4220314/C 02/2020

NOTES: (continued)

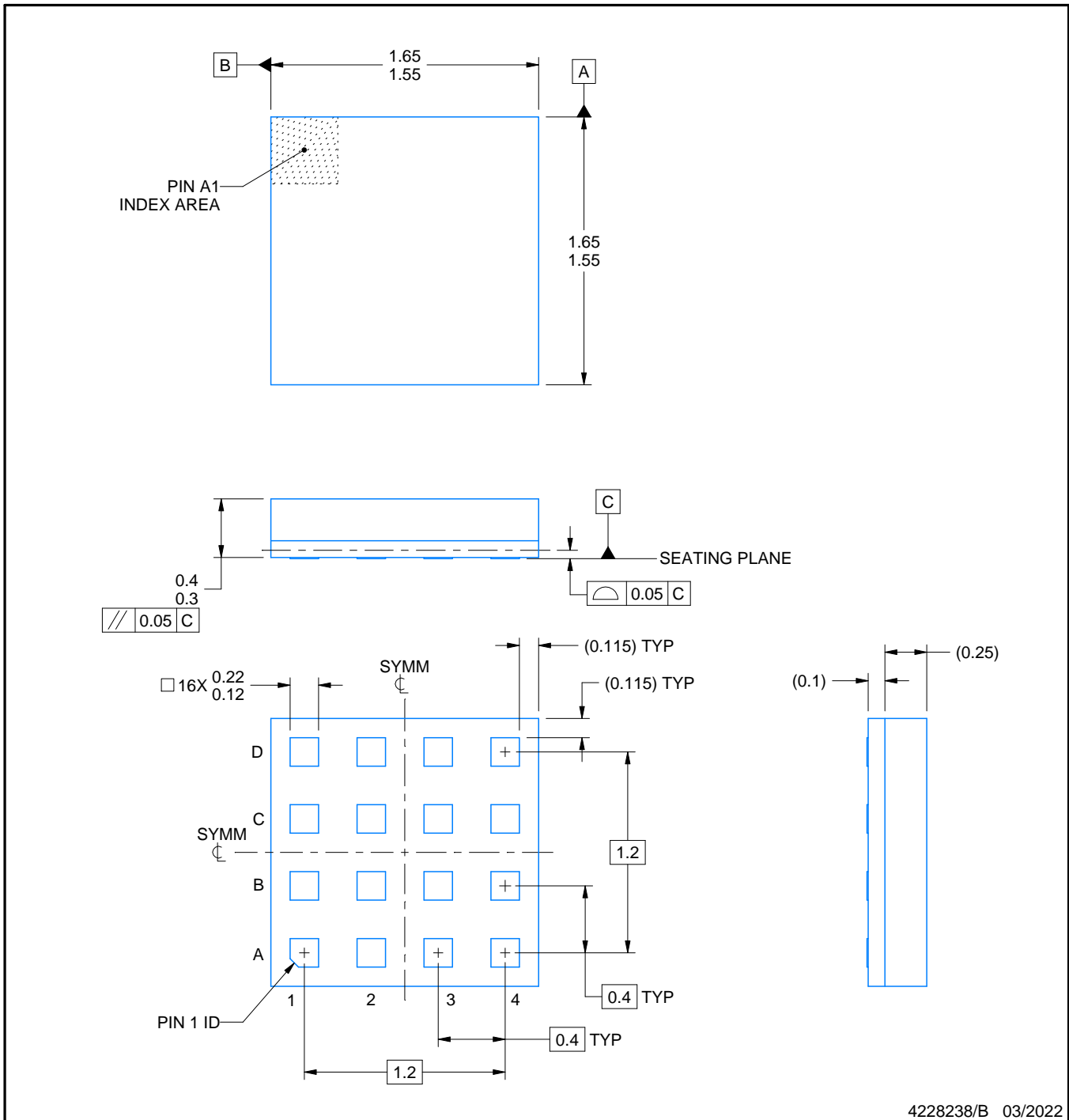
4. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.

DTU0016A



PACKAGE OUTLINE
X2QFN - 0.4 mm max height

PLASTIC QUAD FLATPACK - NO LEAD



4228238/B 03/2022

NOTES:

PicoStar is a trademark of Texas Instruments.

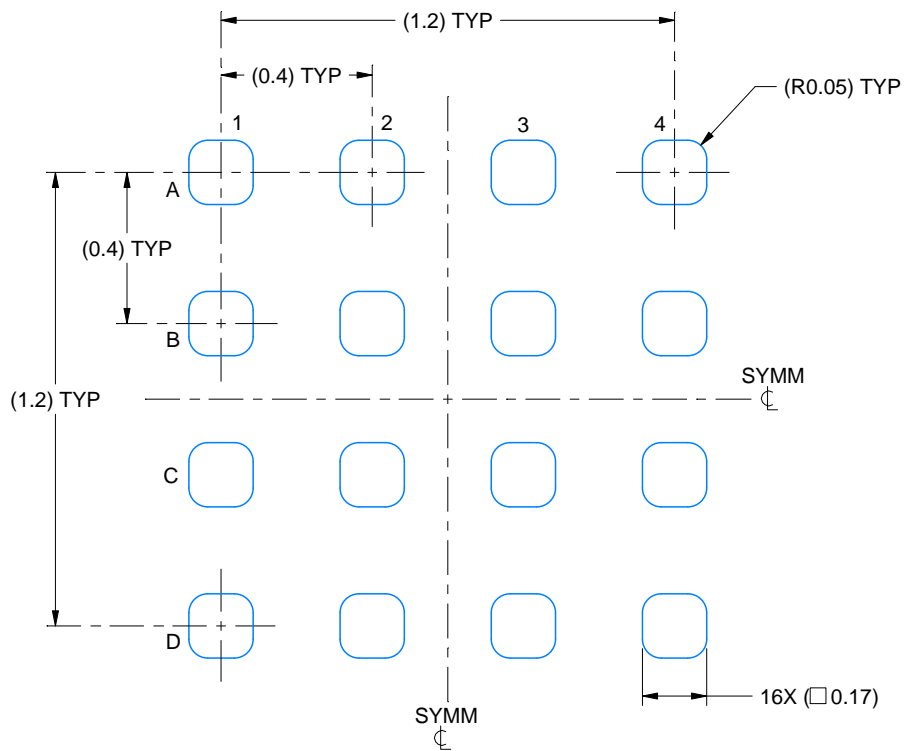
1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This package is for Embedded Application only.

EXAMPLE BOARD LAYOUT

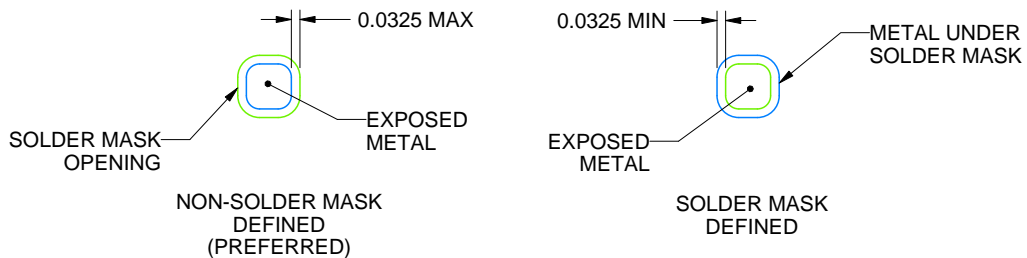
DTU0016A

X2QFN - 0.4 mm max height

PLASTIC QUAD FLATPACK - NO LEAD



LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE:50X



SOLDER MASK DETAILS
NOT TO SCALE

4228238/B 03/2022

NOTES: (continued)

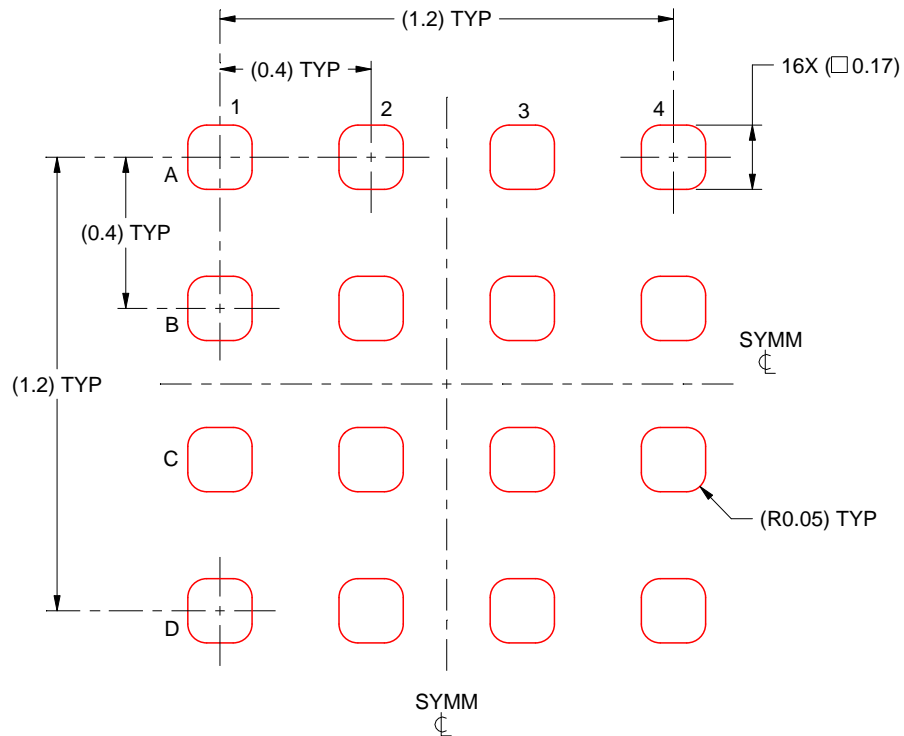
- Final dimensions may vary due to manufacturing tolerance considerations and also routing constraints. For more information, see Texas Instruments literature number SLUA271 (www.ti.com/lit/slue271).

EXAMPLE STENCIL DESIGN

DTU0016A

X2QFN - 0.4 mm max height

PLASTIC QUAD FLATPACK - NO LEAD



SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.0625 mm THICK STENCIL
SCALE:50X

4228238/B 03/2022

NOTES: (continued)

5. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release.

重要なお知らせと免責事項

テキサス・インスツルメンツは、技術データと信頼性データ(データシートを含みます)、設計リソース(リファレンス デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、テキサス・インスツルメンツ製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適したテキサス・インスツルメンツ製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとし、ます。

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されているテキサス・インスツルメンツ製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、テキサス・インスツルメンツはその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。テキサス・インスツルメンツや第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、テキサス・インスツルメンツおよびその代理人を完全に補償するものとし、テキサス・インスツルメンツは一切の責任を拒否します。

テキサス・インスツルメンツの製品は、[テキサス・インスツルメンツの販売条件](#)、または [ti.com](https://www.ti.com) やかかるテキサス・インスツルメンツ製品の関連資料などのいずれかを通じて提供する適用可能な条項の下で提供されています。テキサス・インスツルメンツがこれらのリソースを提供することは、適用されるテキサス・インスツルメンツの保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案した場合でも、テキサス・インスツルメンツはそれらに異議を唱え、拒否します。

郵送先住所：Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265
Copyright © 2025, Texas Instruments Incorporated